

智慧財產及商業法院民事中間判決

110年度民專訴字第27號

原告 碩邦科技股份有限公司

法定代理人 吳非艱

訴訟代理人 李宗德律師

複代理人 顏伯軒律師

訴訟代理人 蔡毓貞律師

輔佐人 黃仁浩

訴訟代理人 劉昱劭律師

陳佩貞律師

被告 易華電子股份有限公司

法定代理人 萬文財

被告 黃嘉能

李宛霞

黃梅雪

蔡金保

夏志雄

林建一

共同

訴訟代理人 黃福雄律師

洪郁棻律師

王吟吏律師

黃耀霆律師

上列當事人間請求確認專利權等（勞動）事件，本院於民國112年11月14日就營業秘密及侵權認定部分言詞辯論終結，並為中間判決如下：

主 文

如附表一編號2技術文件所示之技術內容，為原告所有之營業秘密。

被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄所為申請如附表二編號3所示專利，共同侵害原告所有如附表一編號2所示技術內容之營

業秘密。

事實及理由

壹、程序方面

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。而現行智慧財產案件審理法係於112年8月30日施行，本件係智慧財產案件審理法修正施行前之110年3月15日繫屬於本院(本院卷(一)第20頁)，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、原告提起本件訴訟時，被告易華電子股份有限公司(下稱易華公司)之法定代理人原為黃嘉能（本院卷(一)第298頁），嗣於本院審理時變更為萬文財，有被告易華公司之股份有限公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料在卷可稽（本院卷(七)第23至26、35頁），萬文財並於112年4月17日具狀聲明承受訴訟（本院卷(七)第21頁），於法並無不合，應予准許。

三、按各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同，民事訴訟法第383條第1項定有明文。又關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，修正前智慧財產案件審理細則第35條本文亦有明定。本件原告起訴主張其為如附表一編號1至5所示技術文件(下稱系爭文件A、C、E、F、G，合稱系爭文件)之所有人，系爭文件如附表一所示之技術內容為其之營業秘密，詎被告蔡金保、夏志雄、林建一將上開營業秘密，分別以被告易華公司名義申請並取得如附表二編號1至8所示八件專利(下稱系爭專利庚、辛、壬、癸、癸-1、子、丑、寅，合稱系爭專利)，被告蔡金保、夏志雄、林建一則分別列為如附表二所示系爭專利之發明人或創作人，被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪則基於被告易華公司董事長、總經理、副總經理之身分同意且授意被告蔡金保等人為上開行

為，共同侵害原告之營業秘密及專利申請權，爰請求確認原告為系爭專利之共同申請權人，並請求被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄及林建一對原告負連帶損害賠償之責，被告易華公司並應依民法第28條、公司法第23條第2項之規定與被告黃嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負損害賠償責任，本院認就營業秘密及侵權認定部分，已達於可為裁判之程度，爰先為中間判決。

四、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，不在此限；又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第1款、第256條分別定有明文。本件原告起訴時，訴之聲明第1項原請求確認系爭專利之專利申請權為原告及被告易華公司共有(本院卷(一)第21頁)，嗣於110年10月7日具狀變更為確認原告為系爭專利之共同申請權人(本院卷(二)第6頁)，並經被告等於110年12月28日言詞辯論時當庭表示同意原告前開變更(本院卷(二)第218頁)，揆諸前開規定，核無不合，應予准許。又本件原告起訴時，原於訴之聲明第二項主張被告等7人應連帶負損害賠償責任(本院卷(一)第21頁)，嗣主張各專利之共同侵權人與被告易華公司及其代表人、負責人所應負之損害賠償責任為不真正連帶債務之法律關係，並按各被告應負之連帶賠償責任，而於110年10月7日具狀更正其訴之聲明第二至五項為：被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保及林建一應連帶給付原告新臺幣(下同)180萬元，被告易華公司則應與被告黃嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負責，如前開其中一被告已為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務；被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄及林建一應連帶給付原告380萬元，被告易華公司則應與被告黃嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負責，如前開其中一被告已為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務；被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保及夏志雄應連帶給付原告220萬元，被告易華公司則應與被告黃

01 嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負責，如前開其中一被告已為給
02 付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務；被告黃嘉
03 能、李宛霞、黃梅雪及蔡金保應連帶給付原告220萬元，被
04 告易華公司則應與被告黃嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負責，
05 如前開其中一被告已為給付，其餘被告於其給付範圍內即免
06 除給付之義務（本院卷(二)第6至8頁）。核屬補充、更正事實
07 及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加。

08 五、按確認之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得
09 提起，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確
10 認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，當事人
11 主觀上認其在法律上地位有不安之狀態存在，且此種不安之
12 狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字
13 第1240號判決先例參照）。又按專利申請權及專利權，均得
14 讓與或繼承；專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申
15 請，專利法第6條第1項及第12條第1項分別定有明文。因專
16 利經核准公告後，專利申請權人即成為專利權人，而研發成
17 果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上
18 財產權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依侵權行為等規
19 定提起訴訟，以維護其權利，故應認請求確認專利申請權人
20 或專利權人，有即受確認判決之法律上利益。查原告主張系
21 爭專利部分請求項為其具有實質貢獻之發明、新型，其為專
22 利申請權人之一，則為被告等所否認，雙方就系爭專利之專
23 利申請權歸屬發生爭執，致原告在法律上之地位有受侵害之
24 危險，故原告請求確認其為系爭專利之共同申請權人，自有
25 確認利益。

26 貳、實體方面

27 一、原告主張：

28 (一)原告為國內知名之電子零組件製造業者，以LCD驅動IC封裝
29 及測試為主要營業項目，前於103年8月1日與生產COF(Chip
30 On Film，即捲帶式封裝載板或稱軟性基板)之製造廠欣寶
31 電子股份有限公司（下稱欣寶公司）合併，並以原告為存續

01 公司、欣寶公司為消滅公司，故欣寶公司全部權利、義務及
02 資產均已由原告概括承受。系爭文件A、E、F、G原屬欣寶公
03 司所有，系爭文件C則為欣寶公司向訴外人日商MCS公司價購
04 而受讓取得之技術，則在欣寶公司與原告合併後，系爭文件
05 自屬原告所有。又系爭文件如附表一所示之技術內容涉及原
06 告對於客戶指定之線路圖中特定部位做補償、調整及修飾之
07 具體方法及數值，有助於提升生產良率、品質，或具有提升
08 產線偵錯的準確度及效率等功效，均非一般原理原則或一般
09 涉及該類資訊之人所知，具有實際經濟價值，並已採取合理
10 之保密措施，自屬原告所有之營業秘密。

11 (二)而被告李宛霞、黃梅雪原分別為欣寶公司之總經理、副總經
12 理，於102年中自欣寶公司離職，並在離職前之102年6月23
13 日、24日將欣寶公司終端機伺服器資訊系統內包括系爭文件
14 C、F、G之重要資料夾及檔案全部儲存在三顆硬碟內帶走，
15 旋即受聘於經營相同COF業務之被告易華公司，復於102年底
16 至103年初將欣寶公司之設計工程部部經理即被告蔡金保、
17 研發工程部部經理即被告夏志雄、製程工程部部經理即被告
18 林建一等高階主管挖角至被告易華公司，被告蔡金保則於離
19 職前一日即102年12月5日重製系爭文件A，將其攜至易華公
20 司使用，且被告等任職於欣寶公司期間，被告蔡金保或其所
21 屬之設計工程部對於存放系爭文件A、E之設計部資料夾有存
22 取權限，被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保對於存放系爭文件C
23 之MCS資料夾有存取權限，被告黃梅雪對存放系爭文件F、G
24 之業務部資料夾有存取權限；又被告夏志雄所屬之研發工程
25 部、林建一所屬之製程工程部則對於存放系爭文件A、E之設
26 計部資料夾有存取權限，且不能排除其等有合理接觸系爭文
27 件C、F、G，或在準備系爭專利過程中透過被告李宛霞、黃
28 梅雪、蔡金保接觸系爭文件之可能。詎被告等將上開所接觸
29 系爭文件，以被告易華公司名義申請並取得系爭專利，被告
30 蔡金保、夏志雄、林建一則分別列為如附表二所示系爭專利
31 之發明人或創作人，其中系爭專利之部分請求項內容之實質

01 技術特徵均係出自系爭文件（詳如附表三所示），系爭文件
02 對系爭專利如附表三所示請求項之技術特徵有實質貢獻，原
03 告應為系爭專利之共同申請權人，自得請求確認原告為系爭
04 專利之共同申請權人。

05 (三)被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一原均任職欣
06 寶公司，明知系爭文件所載技術內容為原告所有之營業秘
07 密，被告黃嘉能及易華公司則透過另案刑事案件知悉被告黃
08 梅雪等人所持有之COF技術涉及原告營業秘密，然被告蔡金
09 保、夏志雄、林建一卻將系爭文件所載技術內容，分別以被
10 告易華公司名義申請並取得系爭專利，被告蔡金保、夏志
11 雄、林建一則分別列為如附表二所示系爭專利之發明人或創
12 作人，被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪則基於易華公司之董事
13 長、總經理、副總經理之身分同意且授意被告蔡金保等人為
14 上開行為，渠等所為顯係共同侵害原告之營業秘密及專利申
15 請權，原告自得請求上開被告負連帶損害賠償責任，並請求
16 被告易華公司依民法第28條、公司法第23條第2項之規定，
17 與被告黃嘉能、李宛霞及黃梅雪連帶負損害賠償責任。

18 (四)為此，爰依營業秘密法第12條、民法第184條第1項前段、第
19 185條第1項、第28條及公司法第23條第2項規定，請求擇一
20 命被告等負連帶賠償責任，並聲明：

- 21 1. 確認原告為附表二所示八件專利之共同申請權人。
- 22 2. 被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保及林建一應連帶給付
23 原告180萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應
24 連帶給付原告180萬元，及均自110年3月24日翌日起至清償
25 日止按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被告已
26 為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。
- 27 3. 被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄及林建一應
28 連帶給付原告380萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞及
29 黃梅雪應連帶給付原告380萬元，及均自110年3月24日翌日
30 起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中

01 一被告已為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義
02 務。

03 4.被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保及夏志雄應連帶給付
04 原告220萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應
05 連帶給付原告220萬元，及均自110年3月24日翌日起至清償
06 日止按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被告已
07 為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。

08 5.被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪及蔡金保應連帶給付原告220
09 萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應連帶給付
10 原告220萬元，及均自110年3月24日翌日起至清償日止按週
11 年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被告已為給付，
12 其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。

13 6.就第二項至第五項之聲明，原告願以現金或等值之國內金融
14 機構之無記名可轉讓定期存單提供擔保，請求准予宣告假執
15 行。

16 二、被告等則以：

17 (一)MCS公司並未將系爭文件C讓與或授權給欣寶公司，故系爭文
18 件C為MCS公司而非欣寶公司所有。又COF產品上之線路圖樣
19 與規格結構，係原告客戶即IC設計公司所設計，COF製造廠
20 負責按圖製作而無權片面變更其設計，自非為原告獨有或獨
21 知，原告更將系爭文件F、G對外提供給客戶並流通於業界。
22 況原告所指系爭文件遭系爭專利公開之技術，或已為書籍、
23 論文、產品型錄及專利公報等刊物所公開，或已被廣泛流
24 通、利用，而屬一般涉及該類資訊之人所知者；原告所指系
25 爭文件E、F、G遭系爭專利公開之技術部分，更係顯露於產
26 品外觀而為相關技術領域之人可自產品外觀觀察得知，不具
27 秘密性，縱認具秘密性，系爭文件A、C、F、G之秘密性亦經
28 原告於本院105年度民營訴字第12號案件(下稱另案營業秘密
29 事件)、108年度民專訴字第101號案件(下稱另案確認專利權
30 等事件)主張於102年或107年間遭侵害而喪失；系爭文件既
31 不具秘密性，亦無經濟價值。又欣寶公司並未依文件等級管

理辦法將系爭文件列為機密文件或與員工針對系爭文件簽署
保密契約予以保護，終端機伺服器亦未將系爭文件以不同伺
服器區隔管理或按職務、職級設定權限管制，復未管制網路
連線，更開放系爭文件於個人、部門或共享資料夾、公用電
腦、外接儲存裝置或電磁設備之間進行複製、存取或傳輸，
已難認原告或欣寶公司已採取合理之保密措施。是系爭文件
非屬原告之營業秘密。

(二)如附表一所示系爭文件之技術內容與所對應原告主張之系爭
專利請求項間，所欲解決之問題、達成之功效、採取之手段
皆不同，渠等間之技術特徵非實質相同，且系爭專利均係基
於被告易華公司在被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、
林建一到職前即已掌握之既有技術所衍生之創作，被告易華
公司未利用系爭文件之技術內容申請系爭專利，系爭文件對
系爭專利無實質貢獻。又系爭文件皆屬MCS公司或欣寶公司
之「設計規範」，僅有關於技術手段的記載，而未敘及該技
術手段係用於解決何種問題、達成何種功效之構想，難認係
為發明而完成之精神上創作，原告無從取得系爭文件所載技
術之專利申請權；縱認系爭文件所載技術與系爭專利之技術
特徵間有部分相關，該相關部分亦屬一般涉及該類資訊之人
所知之習知技術，被告易華公司利用公開之技術內容進行改
良並申請系爭專利，自毋庸與原告共有專利申請權。

(三)被告夏志雄或林建一在欣寶公司任職時並未職掌系爭文件，
至被告易華公司後亦未曾接觸或持有系爭文件；被告李宛
霞、黃嘉能亦無接觸或持有系爭文件；又被告蔡金保在欣寶
公司任職時雖有職掌系爭文件，惟至被告易華公司後並未接
觸或持有系爭文件C、E、F、G，更無將系爭文件A攜至被告
易華公司或利用系爭文件A申請系爭專利之行為；而被告黃
梅雪並未接觸或持有系爭文件A、E，至系爭文件C、F、G固
存於被告黃梅雪扣案隨身硬碟，惟係被告黃梅雪遭無預警解
職時不經意攜出，其未曾開啟系爭文件C、F、G，亦未提供
給其他人。因此，被告蔡金保、夏志雄、林建一、黃嘉能、

01 李宛霞、黃梅雪自無侵害原告營業秘密或專利申請權之行
02 為，而被告易華公司則於聘僱被告等時要求其等承諾不得洩
03 漏原雇主業務機密，而簽有機密資訊保密同意書、聲明書，
04 已盡應有之注意義務。

05 (四)聲明：

06 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

07 2.若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

08 三、兩造不爭執事項：(本院卷(一)第479至480頁)

09 (一)被告李宛霞及黃梅雪分別為訴外人欣寶公司（於103年8月1
10 日合併於原告）之總經理及副總經理，於102年中自欣寶公
11 司離職，嗣於103年7月1日受聘於被告易華公司，分別擔任
12 被告易華公司總經理及副總經理職務。被告蔡金保（原欣寶
13 公司設計工程部部經理）、夏志雄（原欣寶公司研發工程部
14 部經理）、林建一（原欣寶公司製程工程部部經理），原為
15 欣寶公司高階主管，渠等於102年底自欣寶公司離職，嗣於1
16 03年4月1日至被告易華公司擔任類似之職務。

17 (二)被告易華公司於107至108年間陸續向我國經濟部智慧財產局
18 及大陸國家知識產權局提出申請並獲准登記為系爭專利之專
19 利權人。依專利公告，被告蔡金保、夏志雄、林建一分別為
20 系爭專利之發明人或創作人之一。

21 四、得心證之理由

22 原告主張其為系爭文件之所有人，系爭文件為其之營業秘
23 密，詎被告蔡金保、夏志雄、林建一將原告上開營業秘密，
24 分別以被告易華公司名義申請並取得系爭專利，被告蔡金
25 保、夏志雄、林建一則分別列為如附表二所示系爭專利之發
26 明人或創作人，被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪則基於被告易
27 華公司董事長、總經理、副總經理之身分同意且授意被告蔡
28 金保等人為上開行為，共同侵害原告之營業秘密及專利申請
29 權，爰請求確認原告為系爭專利之共同申請權人，並請求被
30 告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄及林建一對原
31 告負連帶損害賠償之責，及請求被告易華公司依民法第28

01 條、公司法第23條第2項之規定與被告黃嘉能、李宛霞及黃
02 梅雪連帶負損害賠償責任，則為被告等所否認，並以前詞置
03 辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷(一)第480至481
04 頁，並依判決文字調整），所應審究者為：(一)系爭專利庚請
05 求項1、2、11與原證11之系爭文件E；系爭專利辛請求項1、
06 6與原證13之系爭文件A；系爭專利壬請求項2、4、6、9與原
07 證15之系爭文件C；系爭專利癸請求項1、8及系爭專利癸-1
08 請求項1與原證17之系爭文件F；系爭專利子請求項1、4、
09 9、系爭專利丑請求項1及系爭專利寅請求項7與原證19之系
10 爭文件G，渠等間之技術特徵是否實質相同而可認具實質貢
11 獻？(二)系爭文件A、C、E、F、G是否為原告所有之營業秘
12 密？(三)被告等有無故意或過失侵害原告之營業秘密或專利申
13 請權？原告依營業秘密法第12條第1項、民法第184條第1項
14 前段、第185條、第28條、公司法第23條第2項之規定，請求
15 被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？茲分述如下：

16 (一)如附表一所示之系爭文件對系爭專利請求項是否有實質貢獻

17 1.按發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具
18 有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明、
19 新型而進行精神創作之人，其須就發明、新型所欲解決之問
20 題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想
21 之技術手段。

22 2.系爭文件E之技術內容與系爭專利庚請求項1、2、11實質相
23 同而可認具實質貢獻

24 (1)系爭專利庚技術內容：

25 ①系爭專利庚為中華民國第M586032號「軟性電路板」新型專
26 利案，其主要圖式如附圖一所示；系爭專利庚說明書【先前
27 技術】第【0003】段記載「在製造上，一捲軟性電路板通常
28 包含有呈矩陣排列的數個電路格，而位於同一行的數個電路
29 格係由同一產線所製成。該軟性電路板經裁切後可形成數個
30 電路條，各該電路條具有前述位於同一行的數個電路格；續
31 將各該電路條捲收成卷，以便交予客戶。然而，即使是位於

不同電路條上的電路格，其外觀常非常相似，在裁切後十分難以從單捲電路條的外觀上辨別其原本位於整張軟性電路板上的哪一行；因此，若有客戶反應其電路條有瑕疵狀況，對製造業者而言，將因難以辨別該產品來自哪條產線，而在偵錯上耗費許多時間」（本院卷(一)第48頁），可知系爭專利庚欲解決習知印刷電路板「在裁切成條狀後難以辨識出來自何條產線」之問題。

②系爭專利庚說明書第【0042】段記載「本創作的軟性電路板，可藉由在該廢料區中對應各電路條加入不同的辨識特徵，使該軟性電路板在裁切後仍可輕易辨別各電路條原本位於整張軟性電路板上的哪一行，從而可以在客戶反應有瑕疵時，快速確認出是哪條產線出了問題，具有提升偵錯準確度及效率等功效。此外，本創作在不影響該軟性電路板的用途及外觀下，縮小該辨識特徵之尺寸，又可利於電路條的拼接選擇依據，具有減少退貨及重新製作的可能性。又，本創作可以在廢料區中針對各曝光區加入一辨識特徵，以更進一步地辨識出有問題的電路格是對應於曝光位置的何處，具有提升偵錯精確度及效率的功效」（本院卷(一)第57頁），可知系爭專利庚為解決前述之問題，採用「在軟性電路板之廢料區中，加上可輕易辨識各電路條之辨識特徵」之技術手段，具有在客戶反應有瑕疵時，可快速確認出是哪條產線出了問題，且可進一步地辨識出有問題的電路格是對應於曝光位置的何處，具有提升偵錯準確度及效率之功效。

③系爭專利庚之申請專利範圍共計13項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，就原告所主張之請求項1、2、11內容如下：（本院卷(一)第60至61頁）

①請求項1：一種軟性電路板，包含：一軟板區，具有沿一第一方向並排的數個電路條，各該電路條具有數個電路格，各該電路條的該數個電路格逐一沿一第二方向排列；一廢料區，具有沿該第二方向延伸的數個廢料條，該數個廢料條分別位於各該電路條在該第一方向上的兩側，任二相鄰的前述

01 電路條以兩側的該廢料條互相連接；及數個辨識特徵，各該
02 辨識特徵位於與各該電路條鄰接的廢料區中，且任二前述電
03 路條所對應的辨識特徵不同。

04 ②請求項2：如申請專利範圍第1項所述之軟性電路板，其中，
05 該數個辨識特徵的其中一者係不具任何記號，其餘辨識特徵
06 由至少一記號所構成。

07 ③請求項11：如申請專利範圍第2或3項所述之軟性電路板，其
08 中，各該電路條的每數個電路格形成一曝光區，各該電路條
09 所鄰接的廢料區中對應各該曝光區形成一個前述的辨識特
10 徵，各該電路條的數個辨識特徵相同。

11 (2)系爭專利庚請求項1與系爭文件E技術內容之比對

12 ①系爭文件E為生產COF產品所需要注意的參考設定，其中第8
13 頁繪○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
14 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
15 ○○○(秘保卷第40頁)，對應於系爭專利庚請求項1「一種軟
16 性電路板，包含：一軟板區，具有沿一第一方向並排的數個
17 電路條，各該電路條具有數個電路格，各該電路條的該數個
18 電路格逐一沿一第二方向排列」之技術特徵。

19 ②系爭文件E第9頁「18、曝光識別Mark」項目下記載「○○○
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
21 ○」，並揭露「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」，系爭文
22 件E第9頁揭露○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
23 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(秘保卷第41頁)，對應於
24 系爭專利庚請求項1「一廢料區，具有沿該第二方向延伸的
25 數個廢料條，該數個廢料條分別位於各該電路條在該第一方
26 向上的兩側，任二相鄰的前述電路條以兩側的該廢料條互相
27 連接」之技術特徵。

28 ③依系爭文件E第9頁○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
29 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，系爭
30 文件E第9頁「內凹三角形各排數設計位置圖示」揭露○○○
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ①系爭專利庚請求項1之「辨識特徵」解釋上可涵蓋任何使用
02 時機，且系爭專利庚說明書第【0007】段記載「本創作的又
03 一目的是提供一種軟性電路板，可以在廢料區中針對各曝光
04 區加入一辨識特徵，以更進一步地辨識出有問題的電路格是
05 對應於曝光位置的何處」，第【0042】段記載「本創作可以
06 在廢料區中針對各曝光區加入一辨識特徵，以更進一步地辨
07 識出有問題的電路格是對應於曝光位置的何處，具有提升偵
08 錯精確度及效率的功效」(本院卷(一)第49、57頁)，亦明確記
09 載系爭專利庚請求項1之「辨識特徵」可供辨識出有問題的
10 電路格是對應於曝光位置的何處，此目的與系爭文件E第9頁
11 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(秘保卷第41頁)○○○
12 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
13 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，可
14 作為複數電路條在曝光時之識別特徵，實屬相同，難謂系爭
15 文件E之「曝光識別Mark」與系爭專利庚之「辨識特徵」在
16 識別電路條之本質上有差異。

17 ②被告等所稱之被證7為中華民國新型專利第M590312號「軟性
18 電路板」專利案，其公告日為109年2月1日(本院卷(二)第145
19 頁)，晚於系爭專利庚之申請日(108年7月12日)，自非屬系
20 爭專利庚適格之先前技術。又觀諸系爭專利庚說明書第【00
21 07】、【0042】段(本院卷(一)第49、57頁)記載辨識特徵僅限
22 於軟性電路板在裁切後之辨識客戶反應瑕疵產線，亦可使用
23 於曝光步驟供辨識出有問題的電路格，則使用於曝光步驟時
24 並無裁切或磨損等問題。況電路條裁切時，即使廢料區會受
25 到傳動棘輪、切割導輪等抵壓或摩擦，其磨損、抵壓程度及
26 裁切誤差等，是受到實際棘輪、導輪、裁切刀片等設備與操
27 作因素而異，裁切後仍可能可供辨識，而繼續作為複數電路
28 條所屬產線的識別之用。是被告等上開辯稱均不可採。

29 3.系爭文件A之技術內容與系爭專利辛請求項1、6非實質相同
30 而不具實質貢獻

31 (1)系爭專利辛技術內容：

01 ①系爭專利辛為中華民國第M587421號「印刷電路板之對位圖
02 案系統」新型專利案，其主要圖式如附圖二所示；系爭專利
03 辛說明書【先前技術】第【0003】段記載「請參照第1圖所
04 示，其係一種習知的印刷電路板之對位圖案，該對位圖案可
05 以為十字型，以便在後續組裝電子元件的過程中，機台可以
06 利用影像分析該十字型對位圖案，進行印刷電路板X軸方向
07 與Y軸方向的定位。請再參照第2圖所示，當該習知的十字型
08 對位圖案在蝕刻過程中，可能因蝕刻液表面張力的緣故，造
09 成凸轉角處過度蝕刻，以及凹轉角處蝕刻不足，導致對位圖
10 案因侵蝕不均而造成非十字型，如此，將影響後續封裝對位
11 的問題」(本院卷(一)第72頁)，可知系爭專利辛欲解決習知的
12 印刷電路板「對位圖案」在蝕刻過程中可能產生蝕刻不均之
13 問題。

14 ②系爭專利辛說明書第【0043】段記載「綜上所述，本創作的
15 印刷電路板之對位圖案系統，可以依據設定之基準值及判斷
16 條件，量測並修改印刷電路板之對位圖案，且透過修改對位
17 圖案的轉角處，係可以防止因蝕刻液表面張力的緣故，造成
18 凸轉角處過度蝕刻，以及凹轉角處蝕刻不足等問題，係具有
19 防止對位圖案因侵蝕不均所造成外觀不良，且不會有影響後
20 續封裝對位問題的功效」(本院卷(一)第79頁)，可知系爭專利
21 辛為解決前述之問題，採用「使用印刷電路板之對位圖案系
22 統，對印刷電路板上的對位圖案進行自動化調整」之技術手
23 段，具有防止對位圖案因侵蝕不均所造成外觀不良，且不會
24 有影響後續封裝對位問題的功效。

25 ③系爭專利辛之申請專利範圍共計18項，其中請求項1為獨立
26 項，其餘為附屬項，就原告所主張之系爭專利辛請求項1、6
27 內容如下：(本院卷(一)第83至84頁)

28 ①請求項1：一種印刷電路板之對位圖案系統，包含：一資料
29 庫，用以儲存至少一基準值，該至少一基準值係包含一總長
30 度基準值；及一處理模組，該處理模組耦合連接該資料庫，
31 該處理模組具有一測量單元及一修改單元，該處理模組控制

該測量單元測量一印刷電路板上的對位圖案，以取得至少一測量尺寸，該至少一測量尺寸係包含一總長度，該處理模組比較該總長度及該總長度基準值，當該總長度小於該總長度基準值時，該處理模組控制該修改單元調整該印刷電路板上的對位圖案的輪廓形狀。

②請求項6：如申請專利範圍第1、3或4項所述之印刷電路板之對位圖案系統，其中，該修改單元調整該印刷電路板上的對位圖案為一放大圖案，該放大圖案具有數個外轉角及數個內轉角，各該外轉角具有一外擴部，及各該內轉角具有一內縮部。

(2)系爭專利辛請求項1與系爭文件A技術內容之比對：

①系爭文件A為光罩補償程式之使用手冊，記載生產COF產品之光罩應如何對線路進行補償設計，但系爭文件A係線路圖案之補償設計方法，且非系統或裝置，自未揭露系爭專利辛請求項1「一種印刷電路板之對位圖案系統，包含：一資料庫…；及一處理模組，該處理模組耦合連接該資料庫，該處理模組具有一測量單元及一修改單元，該處理模組控制該測量單元…，該處理模組…該處理模組控制該修改單元」之技術特徵。惟系爭專利辛請求項1之「資料庫」、「處理模組」、「測量單元」及「修改單元」與系爭文件A之差異技術特徵，係系爭專利辛請求項1「比較測量總長度與總長度基準值作為調整對位圖案的輪廓形狀」導入「電腦軟硬體」，以電腦取代人工判斷「蝕刻補償」以進行分析，係電腦軟硬體相關技術領域中通常知識，並且自動化為「電腦軟硬體」本質上之功能，此部分技術特徵（即使用電腦系統，對印刷電路板上的對位圖案進行自動化調整）並非系爭專利辛所欲解決之問題或達成之功效產生構想(conception)，進而提出具體而可達成該構想之技術手段，自非系爭專利辛所不可或缺之必要技術特徵。

②又系爭文件A第5頁記載○○○○○○000000 ○○○0○○
0000○○○0○○○○0000000 0000○○○○○○0○○○

01 4.系爭文件C之技術內容與系爭專利壬請求項2、4、6、9實質
02 相同而可認具實質貢獻

03 (1)系爭專利壬技術內容：

04 ①系爭專利壬為中華民國第I682480號「印刷電路板佈線系
05 統」發明專利案，其主要圖式如附圖三所示；系爭專利壬說
06 明書【先前技術】第【0003】段記載「請參照第1圖，其係
07 一種習知的印刷電路板之線路圖案，該習知印刷電路板的線
08 路末端T通常為直角狀，惟，當習知印刷電路板具有微型化
09 圖案時，在細化線路末端或圖案角落，容易在蝕刻製程中遭
10 受侵蝕，如第2圖所示，侵蝕結果係造成線路末端T產生非預
11 期的不規則凹凸缺痕N，當該印刷電路板通電以進行線路電
12 性測試時，該凹凸變形處容易發生尖端放電現象，而導致該
13 印刷電路板受損、變色而報廢」(本院卷(一)第94頁)，可知系
14 爭專利壬欲解決習知的印刷電路板「線路末端」在蝕刻過程
15 遭受蝕刻之問題。

16 ②系爭專利壬說明書第【0027】段記載「綜上所述，本發明的
17 印刷電路板佈線系統，依據設定之規格條件，檢測並修改印
18 刷電路板之佈線圖案，係可以避免過度蝕刻破壞線路的完整
19 性，具有提升產品良率及節省電路除錯的所需人力及時間的
20 功效」(本院卷(一)第99頁)，可知系爭專利壬為解決前述之問
21 題，採用「使用印刷電路板佈線系統，依據設定之規格條
22 件，自動檢測並修改印刷電路板上之佈線圖案」之技術手
23 段，具有提升產品良率及節省電路除錯的所需人力及時間的
24 功效。

25 ③系爭專利壬之申請專利範圍共計9項，其中請求項1、2為獨
26 立項，其餘為附屬項，就原告所主張之系爭專利壬請求項
27 2、4、6、9內容如下：(本院卷(一)第103至104頁)

28 ①請求項2：一種印刷電路板佈線系統，包含：一資料庫，用
29 以儲存數種線路圖及各該線路圖的數個規格條件，該數個規
30 格條件係包含一第一基準值、一第一改變量及一第二改變
31 量；及一處理模組，用以測量及調整一印刷電路板之線路圖

01 的佈線圖案，該處理模組耦合連接該資料庫，由該處理模組
02 比較該印刷電路板之線路圖，與該資料庫內的數種線路圖及
03 數個規格條件，當該印刷電路板之該線路圖的其中一末端處
04 之圖案寬度小於該第一基準值時，該處理模組依據該第一改
05 變量調整該末端處，當該線路圖的其中一末端處之圖案寬度
06 大於及等於該第一基準值時，該處理模組依據該第二改變量
07 調整該末端處。

08 ②請求項4：如申請專利範圍第1或2項所述之印刷電路板佈線
09 系統，其中，該第一基準值為 $7\sim 27\mu\text{m}$ 。

10 ③請求項6：如申請專利範圍第1或2項所述之印刷電路板佈線
11 系統，其中，該第一改變量為一尖頭長度，該末端處延伸該
12 尖頭長度，該末端處形成尖頭狀，該尖頭長度為 $13\mu\text{m}\sim 20\mu\text{m}$ 。
13

14 ④請求項9：如申請專利範圍第1或2項所述之印刷電路板佈線
15 系統，其中，該第二改變量為一弧角半徑，該末端處之轉角
16 位置形成具有該弧角半徑之導圓角，該弧角半徑 $5\mu\text{m}\sim 20\mu\text{m}$ 。
17

18 (2)系爭專利壬請求項2與系爭文件C技術內容之比對：

19 ①系爭文件C係記載生產COF產品之光罩應如何對線路進行補償
20 設計，但系爭文件C係補償設計方法，並非系統或裝置，自
21 未揭露系爭專利壬請求項2「一種印刷電路板之對位圖案系
22 統，包含：一資料庫，用以儲存數種線路圖及各該線路圖的
23 數個規格條件…；及一處理模組，用以測量及調整一印刷電
24 路板之線路圖的佈線圖案，該處理模組耦合連接該資料庫，
25 由該處理模組比較該印刷電路板之線路圖，與該資料庫內的
26 數種線路圖及數個規格條件，…，該處理模組…，該處理模
27 組…」之技術特徵，前開系爭專利壬請求項2所請為「印刷
28 電路板佈線系統」，該系統具有「資料庫」、「處理模組」
29 等技術特徵依據前述「線路末端蝕刻補償規格條件」技術特
30 徵。惟系爭專利壬「線路末端蝕刻補償規格條件」，以電腦
31 取代人工判斷「蝕刻補償」以進行分析，係電腦軟硬體相關

技術領域中通常知識，並且自動化為「電腦軟硬體」本質上之功能，此部分技術特徵（即使用電腦系統，依據設定之線路末端蝕刻補償規格條件，自動檢測並修改印刷電路板上之佈線圖案），並非系爭專利王所欲解決之問題或達成之功效產生構想(conception)，進而提出具體而可達成該構想之技術手段，自非系爭專利王所不可或缺之必要技術特徵。

②系爭文件C第8頁○0000○○00000○○00000○○00000○○
○0○○○○○○○
0000○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ④綜上，系爭專利壬請求項4、6、9之附屬技術特徵已對應揭
02 示於系爭文件C，系爭專利壬請求項4、6、9為請求項2之附
03 屬項，包含請求項2之所有技術特徵，系爭文件C之技術內容
04 與系爭專利壬請求項2實質相同而可認具實質貢獻已如前
05 述，故系爭文件C之技術內容與系爭專利壬請求項4、6、9實
06 質相同而可認具實質貢獻。

07 (4)至被告等雖辯稱：系爭專利壬請求項2、4、6、9之「資料
08 庫」及「處理模組」以系統進行「自動化線路末端調整」、
09 「線路二側末端」並未為系爭文件C所揭露等語，惟系爭專
10 利壬所為「線路末端蝕刻補償規格條件」，以電腦取代人工
11 判斷「蝕刻補償」以進行分析，係電腦軟硬體相關技術領域
12 中通常知識，並且自動化為「電腦軟硬體」本質上之功能，
13 系爭專利壬請求項2、4、6、9所記載之技術特徵（即使用電
14 腦系統，依據設定之線路末端蝕刻補償規格條件，自動檢測
15 並修改印刷電路板上之佈線圖案）不具有技術上貢獻，已如
16 前述；至於被告等主張「線路二側末端」未揭露於系爭文件
17 C，然前開技術特徵並未進一步限定於系爭專利壬請求項2、
18 4、6、9，被告等主張不可採。

19 5.系爭文件F之技術內容與系爭專利癸請求項1、8實質相同而
20 可認具實質貢獻；系爭文件F之技術內容與系爭專利癸-1請
21 求項1實質相同而可認具實質貢獻

22 (1)系爭專利癸、癸-1技術內容：

23 ①系爭專利癸為中華民國第I687137號「具減少彎折反彈力之
24 軟性電路板」發明專利案，其主要圖式如附圖四所示；系爭
25 專利癸-1為大陸第CZ0000000000號發明專利案，主張系爭專
26 利癸之我國專利之優先權。系爭專利癸說明書【先前技術】
27 第【0003】段記載「習知軟性電路板的各種應用具有導致電
28 性不良的風險，例如：組裝一種電子產品之製程，必須將習
29 知的軟性電路板對折而分為一上半部及一下半部，使該上半
30 部及該下半部分別組合不同的電路模組，其中，該上半部與
31 該下半部之間的間距縮小以達到產品薄型化的目的，將導致

01 連結該上半部及該下半部之一彎折部承受一應力係大於軟性
02 電路板接合處之異方性導電膠(Anisotropic Conductive Fi
03 lm, ACF)的附著力，使組裝完成的電子產品會發生線路剝
04 離、短路、斷路、高阻抗等電性不良的缺陷模式；反之，放
05 寬該上半部與該下半部之間的間距，以減少該彎折部承受之
06 應力，將導致軟性電路板占用組裝空間而影響應用的靈活
07 性」(本院卷(一)第114至115頁)，系爭專利癸-1說明書第【00
08 03】段亦有相對應記載(本院卷(一)第138頁)，可知，系爭專
09 利癸、癸-1欲解決習知的軟性電路板之「彎折反彈力過強，
10 導致電性不良」之問題。

11 ②系爭專利癸說明書第【0044】段記載「綜上所述，本發明的
12 具減少彎折反彈力之軟性電路板，藉由沿彎折部位排列的該
13 至少一導孔，有效減少彎折該絕緣層產生的反彈力及彎折部
14 位的內應力，使軟性電路板可以靈活安裝於空間狹小的電子
15 產品內，並且可以避免該導電層上的電子線路受內應力拉扯
16 而扭曲、斷裂或剝離，具有確保連接軟性電路板的模組正常
17 運作，並可以使產品薄型化」(本院卷(一)第122頁)，系爭專
18 利癸-1說明書第【0068】段亦有相對應記載(本院卷(一)第142
19 頁)，可知系爭專利癸、癸-1為解決前述之問題，採用「在
20 軟性電路板上沿彎折部位排列設置導孔」之技術手段，具有
21 有效減少彎折該絕緣層產生的反彈力及彎折部位的內應力，
22 增加安裝靈活性並可使產品薄型化的功效。

23 ③系爭專利癸之申請專利範圍共計19項，其中請求項1為獨立
24 項，其餘為附屬項，就原告所主張之系爭專利癸請求項1、8
25 內容如下：(本院卷(一)第124至125頁)

26 ①請求項1：一種具減少彎折反彈力之軟性電路板，包含：一
27 絕緣層，該絕緣層具有一折線及位於該折線兩側之一彎折區
28 域；一導電層，該導電層覆蓋於該絕緣層；及至少一導孔，
29 該至少一導孔沿該折線及該折線之平行線排列設置於該彎折
30 區域，該絕緣層及該導電層係沿該至少一導孔彎折，該至少
31 一導孔未延伸至該導電層。

00000 0000 0000 0000 000 00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○
000000 00000○○○○○○○○○○0000 0000 0000 00000○○○○○
0○○○○○○00○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，對應於系爭專
利癸請求項1「至少一導孔，…該至少一導孔未延伸至該導
電層」之技術特徵。又雖系爭文件F第6頁TCP基板結構圖○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，
對應於系爭專利癸請求項1之「…該至少一導孔沿該折線及
該折線之平行線排列設置於該彎折區域，該絕緣層及該導電
層係沿該至少一導孔彎折…」之技術特徵。

③綜上，系爭文件F技術內容已實質揭露前揭系爭專利癸請求
項1之全部技術特徵，系爭專利癸請求項1僅為該系爭文件F
之圖面及文字敘述，故系爭文件F與系爭專利癸請求項1實質
相同而可認具實質貢獻。

(3)系爭專利癸請求項8與系爭文件F技術內容之比對：

①系爭專利癸請求項8係依附於請求項1，並界定「其中，該導
孔的數量為二個，該二導孔係呈現平行該折線之二直線，其
中，該二導孔之一線寬係0.02毫米~1毫米，及該二導孔之間
的一導孔間距係0.2毫米~1毫米」之附屬技術特徵，系爭文
件F對系爭專利癸請求項1具有實質貢獻，已如前述。系爭文
件F第6頁000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○系爭文件F第8頁
○000 0000 0000 0000 000 00000○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○0○○○○○○0○○○○○○0○○○○○○○○○○0○○○○○○
00000○○○○0○○○○○○○○00000(秘保卷第66、68頁)，已對
應揭示系爭專利癸請求項8「其中，該導孔的數量為二個，
該二導孔係呈現平行該折線之二直線，其中，該二導孔之一
線寬係0.02毫米~1毫米，及該二導孔之間的一導孔間距係0.
2毫米~1毫米」之附屬技術特徵。

01 ②綜上，系爭文件F與系爭專利癸請求項8實質相同而可認具實
02 質貢獻。

03 (4)系爭專利癸-1請求項1與系爭文件F技術內容之比對：

04 ①系爭文件F第6頁之TCP基板結構圖(秘保卷第66頁)○○○○
05 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
06 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
08 ○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
09 ○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11 ○○○○○○○○○，此外，系爭文件F第8頁(秘保卷第68頁)
12 揭露○○○○○○○○0○○○○○○00000○○○○0○○○○○
13 00000○已對應揭示系爭專利癸-1請求項1「一種具減少彎折
14 反彈力之軟性電路板，其特徵在于，包括：一層絕緣層，該
15 絕緣層沿一條折線或該折線兩側區域彎折；一層導電層，該
16 導電層覆蓋于該絕緣層；及兩個導孔，該兩個導孔呈現平行
17 該折線的兩條直線設置于與該絕緣層，該兩個導孔未延伸至
18 該導電層，其中該兩個導孔的一個線寬為0.02毫米~1毫米，
19 及該兩個導孔之間的一個導孔間距為0.2毫米~1毫米」之技
20 術特徵。

21 ②綜上，系爭文件F技術內容已實質揭露前揭系爭專利癸-1請
22 求項1之全部技術特徵，系爭專利癸-1請求項1僅為該系爭文
23 件F之圖面及文字敘述，故系爭文件F與系爭專利癸-1請求項
24 1實質相同而可認具實質貢獻。

25 (5)至被告等雖辯稱在軟性電路版技術領域，習知技術（即被證
26 8，本院卷(二)第159至163頁）係在捲帶式封裝（TCP）電路板的
27 彎折區域必須設置狹縫以減少彎折時之反彈力，系爭文件
28 F亦為相同之習知觀念，而系爭專利癸、癸-1之實質特點係
29 在過去被認為不須要設置狹縫之COF電路板上，亦設置可以
30 減少彎折反彈力之不同型態之導孔或盲孔，兩者具有顯著差
31 異之技術特徵。惟系爭專利癸、癸-1說明書第【0002】段提

01 及之COF電路板，僅是例示軟性電路板之可能類型，不得以
02 系爭專利癸、癸-1所載實施方式之例示來限制申請專利範
03 圍，系爭專利請求項1、8、系爭專利癸-1請求項1之「具減
04 少彎折反彈力之軟性電路板」解釋上均可涵蓋使用TCP封裝
05 之軟性電路板與COF封裝之軟性電路板，且系爭文件F已揭露
06 系爭專利癸請求項1、8、系爭專利癸-1請求項1之發明，業
07 如前述，是被告等上開所辯，尚屬無據。

08 6.系爭文件G之技術內容對系爭專利子請求項1、4、9非實質相
09 同不具實質貢獻。

10 (1)系爭專利子技術內容：

11 ①系爭專利子為中華民國第M586029號「具有線路對位記號之
12 軟性電路板」新型專利案，其主要圖式如附圖五所示；系爭
13 專利子說明書【先前技術】第【0003】段記載「詳言之，目
14 前檢查佈線良率的方式，都是將軟性電路板區分成數個鏡頭
15 檢測區，並利用感光耦合元件（Charge Coupled Device，
16 簡稱CCD）鏡頭分別對各該檢測區進行自動光學檢查（Autom
17 ated Optical Inspection，簡稱AOI）；該AOI係將各該鏡
18 頭檢測區由CCD鏡頭所拍攝到的線路圖樣與實際的線路設計
19 電腦繪圖（Computer Aided Design，簡稱CAD）檔做疊對分
20 析，以二者之重合率進行佈線良率之判斷。然而，當CCD鏡
21 頭對到線路圖樣不具任何直角型態的鏡頭檢測區時，所拍攝
22 到的線路圖樣將難以進行偏轉或偏移量的修正，以致前述的
23 AOI頻頻出現錯誤警示，影響AOI的效率。特別是，現今軟性
24 電路板上的佈線常會出現整個鏡頭檢測區都是緊密相鄰的直
25 條狀線路或弧形線路，此時，只要定位稍有偏移，就會出現
26 錯誤警示且難以準確又快速地修正定位」（本院卷(一)第154至
27 155頁），可知系爭專利子欲解決習知的印刷電路板在進行自
28 動光學檢查時，「在線路密集區域容易發生錯誤且難以準確
29 快速地修正定位」之問題。

30 ②系爭專利子說明書第【0038】段記載「綜上所述，本創作的
31 具有線路對位記號之軟性電路板，可藉由在軟性電路板上設

01 ③綜上，系爭文件G之技術內容對系爭專利子請求項1非實質相
02 同而不具實質貢獻。

03 (3)系爭專利子請求項4、9與系爭文件G技術內容之比對：

04 ①系爭專利子請求項4係依附於請求項1，並界定「其中，該定
05 位標記的各邊長為0.05~0.3mm」之附屬技術特徵。系爭文件
06 G之技術內容對系爭專利子請求項1不具實質貢獻，已如前
07 述。系爭文件G第10頁(秘保卷第94頁)繪示○○○○○○○○
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
09 00000，已對應揭示系爭專利子請求項4之附屬技術特徵。

10 ②系爭專利子請求項9係依附於請求項1，並界定「其中，該線
11 路對位記號係呈十字形」之附屬技術特徵。系爭文件G之技
12 術內容對系爭專利子請求項1不具實質貢獻，已如前述。系
13 爭文件G第10頁(秘保卷第94頁)繪示○○○○○○○○○○
14 ○○已對應揭示系爭專利子請求項9之附屬技術特徵。

15 ③綜上，雖系爭專利子請求項4、9之附屬技術特徵已對應揭示
16 於系爭文件G，但系爭專利子請求項4、9為請求項1之附屬
17 項，包含請求項1之所有技術特徵，但系爭文件G之技術內容
18 對系爭專利子請求項1非實質相同而不具實質貢獻，已如前
19 述，且該附屬技術特徵，並非系爭專利子所欲解決之問題或
20 達成之功效產生構想(conception)，並進而提出具體而可
21 達成該構想之技術手段。故系爭文件G之技術內容對系爭專
22 利子請求項4、9非實質相同而不具實質貢獻。

23 (4)至原告雖主張系爭專利子請求項1之「鏡頭檢測區」，不屬
24 於實質的技術特徵，系爭專利子說明書【先前技術】第【00
25 03】段已記載軟性電路板區分成數個鏡頭檢測區，因此將電
26 路層劃分為數個鏡頭檢測區進行檢測為先前技術，非解決問
27 題的技術特徵等語。惟系爭專利子所欲解決之問題是「在線
28 路密集區域容易發生錯誤且難以準確快速地修正定位」之問
29 題，採用技術手段為「使每一個CCD鏡頭檢測區中皆一定具
30 有特定圖案之線路對位記號」之技術手段，使CCD鏡頭拍攝
31 到的線路圖樣能夠快速且準確定位；亦即習知技術中，不是

01 每一個鏡頭檢測區都具有足以供快速且準確定位的特定圖案
02 之線路對位記號，當CCD鏡頭對到線路圖樣不具任何特定圖
03 案的鏡頭檢測區時，所拍攝到的線路圖樣將難以進行偏轉或
04 偏移量的修正，以致檢測中頻頻出現錯誤警示，影響檢測效
05 率。因此，系爭專利子請求項1之「各該鏡頭檢測區中具有
06 數個線路部以構成一線路圖樣；及數個線路對位記號，各該
07 線路對位記號具有至少一直角部，該數個線路對位記號位於
08 該數個鏡頭檢測區中且不與各該線路部重疊」之技術特徵，
09 利用具有直角部的該線路對位記號，並使該數個線路對位記
10 號位於該數個鏡頭檢測區中，是系爭專利子請求項1之創作
11 達到快速且精準定位前開差異技術特徵為發明或新型所欲解
12 決之問題或達成之功效所不可或缺的必要技術特徵，具技術
13 上貢獻，系爭專利子之數個具有直角部的該線路對位記號的
14 技術特徵，必須位於對應之數個鏡頭檢測區中才能解決系爭
15 專利子所欲解決之問題、達到系爭專利子之創作目的，不能
16 切割或忽略；而系爭文件G之內容僅有對位記號圖案，但未
17 揭露以光學鏡頭進行檢測時之具體內容，不知鏡頭檢測區與
18 對位記號間之對應關係，在系爭文件G未揭露前述內容的情
19 形下，自不能認為系爭文件G所解決問題、解決問題之技術
20 手段和系爭專利子請求項1具有實質貢獻，故原告上開主張，
21 自屬無據。

22 7.系爭文件G之技術內容與系爭專利丑請求項1實質相同而可認
23 具實質貢獻

24 (1)系爭專利丑技術內容：

- 25 ①系爭專利丑為中華民國第M586506號「印刷電路板之補強
26 塊」新型專利案，其主要圖式如附圖六所示；系爭專利丑說
27 明書【先前技術】第【0004】段記載「習知的印刷電路板9
28 上的各導電線路形成後，需在非焊接位置的部位上覆蓋一防
29 焊層（Solder Resist），該防焊層具有防潮、絕緣、防
30 焊、耐高溫及美觀等作用，該防焊層係藉由網版印刷以特定
31 形狀塗佈在該印刷電路板9上，惟，電子線路的微型化趨勢

000000000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○○○○○○○別相當於系爭專利丑請求項1之「補
強塊」、「強化部」、「空白部」；前述在COF基板邊緣之
導電線路所包圍的區域中，形成由複數個凸塊、複數個空白
區域交錯排列構成之虛擬引腳，引腳為導線圖案，突出於基
板上，即可對應於系爭專利丑請求項1「一種印刷電路板之
補強塊，包含：數個強化部，各該強化部係位於一印刷電路
板之表面的凸塊；及數個空白部，各該空白部係位於該數個
強化部之間的低凹處；該數個強化部及該數個空白部係交錯
排列於該印刷電路板之外邊區域，其中一強化部緊鄰該印刷
電路板之一外緣線路」之技術特徵。

②綜上，系爭文件G技術內容已實質揭露前揭系爭專利丑請求
項1之全部技術特徵，系爭專利丑請求項1僅為該系爭文件G
之圖面及文字敘述，故系爭文件G與系爭專利丑請求項1實質
相同而可認具實質貢獻。

③至被告等雖辯稱系爭文件G第10頁(上標第11 of 14頁)第7.
5.2節之附圖與第4頁(上標第5 of 14頁)之COF結構圖，二圖
無法對應，不能瞭解第7.5.2節附圖所示之Dummy Lead(虛擬
引腳)應設置於COF結構的何處，亦未揭露虛擬引腳設於印刷
電路板之彎折區域內，與系爭專利丑請求項1之「部分設置
於印刷電路板彎折區域內的補強塊」之技術特徵有差異，甚
至虛擬引腳亦可能是單純用於散熱等語，惟系爭文件G第10
頁(上標第11 of 14頁，秘保卷第94頁)第7.5.2節之附圖○
○○
，系爭
文件G第7.5.2節附圖之傳動孔可對應到系爭文件G第4頁(上
標第5 of 14頁，秘保卷第88頁)COF結構圖之傳動孔，可知
系爭文件G第7.5.2節附圖○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○
；又無論虛擬引腳
是否另外有散熱功效，不影響系爭文件G之虛擬引腳可對應

於系爭專利丑請求項1之補強塊。是被告等上開所辯自非可採。

8.系爭文件G之技術內容對系爭專利寅請求項7非實質相同而不具實質貢獻

(1)系爭專利寅技術內容：

①系爭專利寅為中華民國第M586030號「具有孔位檢查記號之軟性電路板」新型專利案，其主要圖式如附圖七所示；系爭專利寅說明書【先前技術】第【0004】段記載「惟，目前檢測該沖孔的實際位置是否落於可容許誤差範圍內的方式，都是要找尋該電路層中型態較特殊而易於對位的部位來作為比對的參考點，利用感光耦合元件（Charge Coupled Device，簡稱CCD）鏡頭來進行自動光學檢查（Automated Optical Inspection，簡稱AOI）。然而，該電路層的圖樣變化大，有些電路層易於找參考點，有些則不易；或是有些可作為參考點的部位又離該沖孔太遠，當參考點與沖孔無法位於同一CCD鏡頭的檢測範圍內時，則需要重新調整檢測範圍的大小及焦距，造成檢測步驟繁瑣、多變且效率難以提升」（本院卷(一)第184至185頁），可知系爭專利寅欲解決習知的印刷電路板「在光學鏡頭檢測區內未同時設置參考點及沖點，導致檢測不易」之問題。

②系爭專利寅說明書第【0040】段記載「綜上所述，本創作的具有孔位檢查記號之軟性電路板，由於各沖孔周邊在指定的CCD鏡頭檢測範圍（即該檢測區）內都具有至少一個與線路層一併成型的記號，可在不影響用以傳遞控制訊號之電路設計的前提下，設置用以進行孔位檢查的記號，故可藉由計算該記號與該沖孔的相對位置，快速且準確地檢測出沖孔的實際位置是否符合可容許的誤差範圍，具有提升檢測沖孔位置之準確度、設置便利性及作業效率等功效」（本院卷(一)第193頁），可知系爭專利寅為解決前述之問題，採用「在各沖孔周邊的CCD鏡頭檢測區內設置至少一個與線路層一併成型的記號」之技術手段，可藉由計算該記號與該沖孔的相對位

置，快速且準確地檢測出沖孔的實際位置是否符合可容許的誤差範圍，具有提升檢測沖孔位置之準確度、設置便利性及作業效率等功效。

③系爭專利寅之申請專利範圍共計11項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，查系爭專利寅請求項7係直接或間接依附於系爭專利寅請求項1、2、5、6，包含請求項1、2、5、6全部技術特徵，而系爭專利寅請求項1、2、5、6、7內容如下：(本院卷(-)第197至198頁)

①請求項1：一種具有孔位檢查記號之軟性電路板，包含：一基板，具有數個空白區；一線路層；數個記號，與該線路層一併成型於該基板，該線路層及該數個記號均不位於該數個空白區中；數個沖孔，分別對應各該空白區貫穿該基板；及數個檢測區，各該檢測區中具有至少一個前述的記號及一個前述的沖孔。

②請求項2：如申請專利範圍第1項所述之具有孔位檢查記號之軟性電路板，其中，該基板具有一廢料區位於一佈線區的外周，該數個空白區與該佈線區重疊，該線路層位於該佈線區，該線路層具有一輸入部及一輸出部，該數個沖孔位於該輸入部與該輸出部之間。

③請求項5：如申請專利範圍第2項所述之具有孔位檢查記號之軟性電路板，其中，各該檢測區中的前述記號位於該基板的佈線區。

④請求項6：如申請專利範圍第5項所述之具有孔位檢查記號之軟性電路板，其中，各該檢測區中的前述記號位於該輸入部與該輸出部之間。

⑤請求項7：如申請專利範圍第6項所述之具有孔位檢查記號之軟性電路板，其中，該基板具有一支撐條設置區與該佈線區重疊，該線路層具有數個支撐條，該數個支撐條及該記號位於該支撐條設置區中。

(2)系爭專利寅請求項7與系爭文件G技術內容之比對：

系爭文件G係COF設計規範書，系爭文件G第4頁(上標第5 of 14頁)之「1. Structure of COF」項目下繪示了COF基板結構圖，系爭文件G第10頁(上標第11 of 14頁)之「0000000000 0000 00 00000 00000 000000」項目下繪示虛擬引腳(dummy lead)的設計(秘保卷第88、94頁)，其中所繪○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，對應於系爭專利寅請求項7「該數個支撐條……位於該支撐條設置區中」之技術特徵，惟系爭專利寅請求項7係直接或間接依附於系爭專利寅請求項1、2、5、6，包含請求項1、2、5、6全部技術特徵，有關係爭專利寅請求項7所依附之系爭專利寅請求項1、2、5、6的技術特徵，原告並未比對及說明，系爭文件G僅揭露系爭專利寅請求項7之「基板具有該數個支撐條…位於該支撐條設置區中」之技術特徵，未揭露其他技術特徵，且該附屬技術特徵並非系爭專利寅說明書第【0004】、【0040】段「在各沖孔周邊的CCD鏡頭檢測區內設置至少一個與線路層一併成型的記號」所欲解決之問題或達成之功效產生構想(conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。是系爭文件G之技術內容與系爭專利寅請求項7非實質相同而不具實質貢獻。

- (3)至原告雖主張：系爭文件G雖僅揭露「基板具有該數個支撐條」而未揭露系爭專利寅請求項7中其他技術特徵，但支撐條既為系爭專利寅請求項7之技術特徵之一，而系爭文件G揭露支撐條，則原告已對系爭專利寅請求項7之支撐條具有實質貢獻等語。惟系爭專利寅所欲解決之問題是「在光學鏡頭檢測區內未同時設置參考點及沖點，導致檢測不易」之問題，採用技術手段為「在各沖孔周邊的CCD鏡頭檢測區內設置至少一個與線路層一併成型的記號」之技術手段，提升檢測沖孔位置之準確度。因此，系爭專利寅請求項7之「記號」、「沖孔」、「檢測區」及「佈線區」等技術特徵是系爭專利寅請求項7之創作達到提升檢測沖孔位置之準確度所不可或缺、具有實質貢獻的技術特徵，不能切割或忽略；況

01 且，系爭文件G之內容僅揭露「基板具有該數個支撐條」，
02 與系爭專利寅請求項7所欲解決之問題、技術手段及功效等
03 均大不相同，系爭文件G之技術內容對系爭專利寅請求項7不
04 具實質貢獻，原告主張不可採。

05 9.綜上，系爭文件E之技術內容與系爭專利庚請求項1、2、11
06 實質相同而可認具實質貢獻；系爭文件A之技術內容與系爭
07 專利辛請求項1、6非實質相同而不具實質貢獻；系爭文件C
08 之技術內容與系爭專利壬請求項2、4、6、9實質相同而可認
09 具實質貢獻；系爭文件F之技術內容與系爭專利癸請求項1、
10 8、系爭專利癸-1請求項1實質相同而可認具實質貢獻；系爭
11 文件G之技術內容與系爭專利子請求項1、4、9非實質相同而
12 不具實質貢獻；系爭文件G之技術內容與系爭專利丑請求項1
13 實質相同而可認具實質貢獻；系爭文件G之技術內容與系爭
14 專利寅請求項7非實質相同而不具實質貢獻。

15 (二)系爭文件A之部分技術內容、C為原告所有之營業秘密

16 1.原告主張系爭文件A、E、F、G原屬欣寶公司所有，系爭文件
17 C則為欣寶公司向MCS公司價購而受讓取得之技術，則在欣寶
18 公司與原告合併後，系爭文件自屬原告所有等情，被告固不
19 否認系爭文件A、E、F、G為原告所有，惟就系爭文件C部分
20 則否認MCS公司已將該文件讓與或授權予欣寶公司，自非原
21 告所有之文件。經查，欣寶公司與MCS公司於100年12月26日
22 簽立移轉交易合約，約定欣寶公司以買賣方式取得MCS公司
23 所有產製COF產品設備，及MCS公司應轉讓或授權為使用第二
24 代G2新蝕刻製程以產製COF產品所必要之技術與欣寶公司，
25 並於附件中記載待轉讓或授權之技術是關於新蝕刻G2製程及
26 產製COF產品檢測之技術，包含新蝕刻G2製程及COF設計規
27 則，為小於25微米的細間COF圖案而開發之蝕刻製程；製造C
28 OF用的AOI相關設備及操作標準；製造COF用的多重線路EI相
29 關設備及操作標準；製造COF用的多重線路AVI相關設備及操
30 作標準，且本技術相關專利、專利申請案、有關之專有知識
31 均應於102年3月31日前轉讓與欣寶公司，有欣寶公司與MCS

01 公司簽署移轉交易合約、交割聲明及中譯本節本等件在卷可
02 稽（本院卷(三)第9至52頁），復觀諸系爭文件C內容（秘保卷
03 第15至31頁），均係關於COF產之光罩應如何對原始線路圖
04 進行補償設計之技術資料。又依前述合約內容，可知欣寶公
05 司自MCS公司取得於產製COF產品檢測之技術，不限於該等技
06 術之專利、專利申請案，更包含該等技術所有之專有知識內
07 容等，並參以系爭文件C之技術內容包含COF補償規則，足認
08 欣寶公司向MCS公司依前述交易合約價購取得之技術確包含
09 系爭文件C。被告等徒以系爭文件C非於交割聲明為標的為由
10 否認前情，並無提出其他事證以茲證明，實非可取。基此，
11 系爭文件原均為欣寶公司所有，復因欣寶公司於103年8月1
12 日與原告合併，合併後原告為存續公司，欣寶公司為消滅公
13 司，欣寶公司全部資產及權利、義務均由原告概括承受，是
14 系爭文件均為原告所有。

15 2.按營業秘密法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配
16 方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而
17 符合左列要件者：1. 非一般涉及該類資訊之人所知者。2. 因
18 其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3. 所有人已採取
19 合理之保密措施者，營業秘密法第2 條定有明文。營業秘密
20 之要件有秘密性、經濟價值及保密措施，當營業秘密所有人
21 主張其營業秘密遭第三人侵害時而請求損害賠償，通常應證
22 明具備營業秘密要件之事實。而營業秘密要件之判斷次序，
23 應先就主張為營業秘密之客體或標的，判斷是否有秘密性；
24 繼認定是否具有經濟價值；最後以主觀上有管理秘密之意思
25 與客觀上管理秘密之狀態，以審究所有人是否盡合理之保密
26 措施。所謂「秘密性」，係採「業界標準」，就技術性營業
27 秘密之類型，主要包括與特定產業研發或創新技術有關之機
28 密，包括方法、技術、製程及配方等，非可於市場上或專業
29 領域內依一般通常方法取得之資訊。所謂經濟性者，係指凡
30 可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可以產出經濟
31 利益或商業價值之資訊，即有經濟性，且不以已獲得實質金

錢對價為限，包含實際及潛在之經濟價值，某項秘密資訊係經過時間、勞力、成本之投入所獲得，在使用上不必依附於其他資訊而獨立存在，除帶來有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、業界領先時間等經濟利益或競爭優勢者等；他人擅自取得、使用或洩漏之，足以造成秘密所有人經濟利益之損失或競爭優勢之削減，即具有潛在經濟價值。另所謂合理保密措施，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如：與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等，若營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管，即足當之。以下就原告主張系爭文件如附表一各編號技術內容欄所示資訊，是否具備上開營業秘密三要件分別論述之。

3.秘密性

- (1)被告等分別以如附表四所示之證據及被證7、8、17至20、43至52、68至72，以及部分技術內容會外顯於軟性電路版上，辯稱系爭文件如附表一所示之技術內容不具秘密性，其中就被證10部分(本院卷(二)第323至325頁)，為Stella公司網站對Stella Vision for JAVA系列軟體之簡介，由被證27之公證書附件5至8(本院卷(三)第537至547頁)，於網站時光回溯器，可知被證10之公開日期為西元2016年12月20日；而被證11部分(本院卷(二)第327至335頁)，為Stella公司網站之Fine Vision版軟體功能說明，該網頁第1列顯示Stella vision至Video movie等按鈕與被證10等按鈕得互相核對，可知被證11之公開日期與被證10之公開日期相同。又系爭文件A、C之完成日期分別為西元2011年11月30、2012年4月13日，均早於被告等所提出之被證10、11，是被證10、11自不得作為用以證

明系爭文件A、C不具秘密性之適格證據；至如附表四所示之其餘證據之公開日期均在系爭文件完成日前，自得作為用以證明系爭文件是否具秘密性之適格證據，而被證7、43至52、68至72部分，因系爭文件E、F、G如附表一所示之技術內容已外顯於產品上（詳後述），故不再贅述被證7、43至52、68至72部分是否足以證明系爭文件E、F、G不具秘密性，均先予敘明。

(2)系爭文件A部分

①系爭文件A第5頁記載○○○○○ 000000 ○○○○0○○ 0000○○○○0○○○○○○○○0 000000 ○○○○○○0○○ ○○○00○○00○0，係說明生產COF產品之光罩應如何對原始線路圖進行補償設計，藉由上述補償設計，將光罩上的具有補償設計圖形轉移到所在COF上，蝕刻製程結束，在COF上重新產生線路圖符合原始電路圖的規格時，則對上述光罩的原始線路圖補償設計進行去除，是以該COF產品完成後，該光罩的原始線路圖補償設計不會外顯於產品，且非一般涉及該類技術領域之人所能知悉，自具秘密性。被告等雖辯稱依被證12至16、39至41足以證明系爭文件A不具秘密性等語，惟由被證12第3頁蝕刻因子為拉出尖角(本院卷(三)第495頁)、被證13 Stella Vision for JAVA 概要說明書第51頁蝕刻項目拉出尖角7 (本院卷(三)第498頁)、被證14揭露線路前端形狀調整為具有加長加寬、弧角之導圓角(本院卷(三)第499、732頁)、被證15揭示圖案前端「拉出尖角」或「內凹尖角」(本院卷(三)第734頁)、被證16在圖案前端轉角處拉出尖角(本院卷(三)第503頁)等所揭示之「線路前端或線路轉角處形狀調整及參數設計內容」均未涉及「線路長度」參數，未揭示系爭文件A之以「長腳不足」作為基準參數設計，在未具有前揭「參數」情況下，就一般涉及該類技術領域之人所知者顯然無法透過被證10至16模擬產生「長腳不足」所對應「參數數值」。再由被證39之「高密度印刷電路板技術」書籍第165頁(本院卷(五)第377頁)、被證40之「電路板影像轉移技術」

傳動孔旁有「內凹三角形標記」即明（本院卷(二)第487頁），自難認系爭文件E如附表一所示之技術內容具有秘密性。是被告等辯稱系爭文件E遭系爭專利公開之技術部分，已顯露於產品外觀，不具秘密性等語，即屬有據。

(5)系爭文件F部分

原告雖主張系爭文件F係COF與捲帶式載體封裝(簡稱TCP)產品之設計規範書，如附表一編號4所示之技術內容為其營業秘密，而第6頁○000000 0000000000○○○○○○○○000○
000○○○○○○○○000○○○○○○○○○○○○○○0000000000
00000○000○○○○○○○○○○(秘保卷第66頁)；第8頁
○000 0000 00000000 000 00000○○○○○○○○○○○○
○○○○○0○○○○○0○○○○○0○○○○○○○○0○○○○
○00000○○○0○○○○○○00000○○○○○○○○(秘保卷
第68頁)；第19頁○000 00000 0000 000000 00 0000 0000
00000000 000 00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○0000
0000 0000 00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○000000
00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(秘保卷第79
頁)。惟上開○○○○○00000000 00000○○000○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○均外顯於產
品外觀且於市場流通，此觀被證8論文記載TCP上必須開設
狹縫……COF不須開設狹縫（本院卷(二)第159至163頁），以
及被證18、19晶門科技股份有限公司SSD1805、SSD1815產
品型錄明顯可見彎折孔、沒有導電線路部分增加虛擬引腳
即明（本院卷(二)第540、572、573頁），自難認系爭文件F
如附表一所示之技術內容具有秘密性。是被告等辯稱系爭
文件F遭系爭專利公開之技術部分，已顯露於產品外觀，不
具秘密性等語，即屬有據。

(6)系爭文件G部分

原告雖主張系爭文件G係COF設計規範書，如附表一編號5所
示之技術內容為其營業秘密，而第1頁(上標第2 of 14頁)

01 系爭文件A、C係記載生產COF產品之光罩應如何對原始線路
02 圖進行補償設計，增加蝕刻時對線路良率，而在市場上取得
03 相當競爭地位，若競爭對手取得該等資訊，將得以掌握原告
04 之光罩線路補償資訊，縮短研究時間及成本，並與原告競爭
05 相同產品之客戶，足以造成原告經濟利益之損失、削減其競
06 爭優勢，是該等資訊自屬可用於生產且具有經濟價值之資
07 訊。

08 5.合理保密措施

09 (1)原告主張欣寶公司設有終端機伺服器集中管理電子檔案，並
10 透過配發員工個人專屬帳號、密碼，按員工職級設定不同存
11 取權限之方式管制機密文件，又系爭文件A與系爭文件C分別
12 存放於公司內部電腦終端伺服器之設計部資料夾、MCS專用
13 資料夾等情，業據其提出欣寶公司資料管控電腦畫面截圖
14 (原證23)、系統使用管理作業(原證24)、網路系統管理作
15 業辦法(原證64、98)、欣寶公司TerminalSolution系統架
16 構說明(原證62)、資訊系統需求申請表(原證68、69)、欣寶
17 公司資訊系統二期專案買賣合約書(原證60)等件在卷為憑
18 (本院卷(一)第280至288、290至293頁、卷(三)第241至258、26
19 9至274、277至281、289至291頁、卷(六)第217至221頁)；再
20 觀諸原告提出還原磁帶及檢視存取權限過程之公證書(原證9
21 3)(本院卷(五)第13至281頁)，亦見系爭文件A、C當時存放
22 於欣寶公司伺服器中並設有存取權限，其中系爭文件A存放
23 於【CAD設計部(專用)】資料夾，如扣除環境測試電腦、S
24 tella軟體專用電腦及已離職員工(本院卷(五)第7頁)，設有
25 24名有權限存取人員；系爭文件C存放於【5-3-設計技術Gr
26 (CAD設計相關)-保哥】資料夾，如扣除已離職員工(本院
27 卷(五)第8頁)，設有13名有權限存取人員；併參酌被告李宛
28 霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一於任職欣寶公司時，
29 均至日本MCS公司為相關技術轉移受訓，且經欣寶公司寄發
30 員工派外培訓協議書給該等被告，有101年1月16日電子郵件
31 暨所附員工派外培訓協議書等件在卷可查(本院卷(三)第357

至359頁），而依員工派外培訓協議書協定內容所載，員工應保證遵守保密合約不將培訓所獲得之各項資訊，例如圖說、技術、文件等外流或提供予非主管授權人員等語，益徵欣寶公司當時確實將自MCS公司價購取得之技術移轉內容視為秘密，且對於被告等派外接受技術移轉員工要求簽立前開協議書，約定其等不得將該等資訊外流或洩漏他人。是原告主張有為前開保密措施等情，尚非無據。

(2)又證人即欣寶公司資訊部經理（現為原告公司員工）孫安勇於另案刑事案件審理時均證稱：我於92年間欣寶公司建廠至原告合併迄今均在欣寶公司工作，擔任資訊部經理，欣寶公司92年間建廠時，李宛霞就跟我說要比照亞洲微電模式做資訊管控，希望建置終端機伺服器系統環境，直到93年後期到104年間開始執行建置終端機伺服器之任務，設置該系統主要目的是軟體與檔案資料要集中由公司控管，且要把USB關閉，不要讓資料外洩，我們有做到集中軟體控管與USB裝置控管，以避免資料自USB外洩，欣寶公司於95年8月施行系統使用管理作業，員工進入欣寶公司後，都要提出申請終端機帳號，資訊部會依照部門主管告知員工之職位及工作職掌，經過核可，才會進行設定存取員工帳號、密碼對應之權限，終端機伺服器資料夾權限分為個人資料夾、部門資料夾、跨部門資料夾，若員工點選非權限內之資料夾，會出現沒有使用資料夾之權限，被拒絕存取之警示，需要員工透過資訊系統需求申請表提出申請，且經核可，資訊部才會執行開放權限，以MCS專區來說，因為屬於公司高度機密，開放權限部分一定會有最高主管李宛霞、黃梅雪簽核；另員工經核准使用外網權限後，公司管控方式分兩類，其一是網路設定直接過濾不當網站，例如色情、暴力網站，其二會有1個月內之上網紀錄。另欣寶公司買進終端機伺服器資訊系統時，即要求廠商直接把這個裝置關閉，所以終端機電腦無法使用USB等語（本院卷(三)第130至135、139、143頁、卷(七)附件7），其所證稱設定存取權限一事亦核與原告所提出之欣寶公司當

01 時資料夾儲存讀取權限表相符（本院卷(三)第125至127頁）。
02 復有證人即欣寶公司製程工程師（現為被告易華公司員工）
03 伍世宏於另案刑事案件審理時證稱：我在欣寶公司使用的終
04 端機電腦系統需有個人帳戶、密碼才能使用工作，且不能使
05 用USB，公用PC可以用USB，不能讀取其他部門的電子檔案等
06 語（本院卷(二)第650至652頁、卷(七)附件7）；證人即欣寶公司
07 業務部員工王佩懿於另案刑事案件審理時證稱：我是業務部
08 人員，如果需要看其他部門資料，會提出申請，如為長期跨
09 部門讀取資料，會使用需求表向資訊部申請，以欣寶公司管
10 理原則，一定要李宛霞總經理或黃梅雪副總經理同意才能有
11 這樣的權限，又欣寶公司設有文件管制中心，李宛霞當時是
12 該中心主管，最後核可者是她，文件管制作業程序主要在規
13 範公司所有ISO文件，即國際標準認證的所有作業流程都要
14 文件化、制度化辦法，要怎麼管理、回收、開放、哪些人有
15 權限，我認為這都是屬於權限之控管，對我而言，我看不到
16 的資料都是屬於機密，因為無法互相分享，我有試過點選沒
17 有權限之資料夾，但是點不進去，點了會顯示我沒有權限。
18 基本上各部門依作業流程都要文件化進入文件管制中心管
19 理，一般員工沒有權限進去文件管制中心閱覽文件，要透過
20 填寫文件借閱之申請表單，我是負責把三井專利移轉進來的
21 對口，MCS公司人員在交接會議表示這些MCS專利轉讓及相關
22 Know-how等都沒有對外公開，此經MCS公司在日本當地政府
23 機關公證此事，對我們廠內來講，MCS資料就是機密，所有
24 存放MCS資料夾就是以機密資料方式控管，無法對外公開，
25 也不得放在公用資料夾分享。另我在欣寶公司是使用終端機
26 電腦系統，不能使用USB，因為業務部必須分析產業訊息，
27 我有填寫資訊需求表申請對外連結網路，並非全公司的人都
28 可以使用終端機連到外面網路，需要與業務職掌相關等語
29 （本院卷(三)第206至207頁、卷(四)第106至108頁、卷(六)第78
30 頁、卷(七)附件7），均可見欣寶公司於93年間執行建置終端機
31 伺服器，由資訊系統建置文件，並管控於電腦設備使用USB

裝置，僅有業務需求少數開放使用，以避免資料經由USB儲存裝置流出，又對外網路及電子郵件均設有權限管制，有業務需求者，須填「資訊系統需求申請表」等表單，經主管核可後始得使用對外網路及電子郵件。

- (3)另審酌被告黃梅雪於另案刑事案件調查時陳稱：以我在欣寶公司之層級，是隨時都可以查詢到新蝕刻技術、MCS技術之相關檔案或資料，但一般員工因業務需要，如果必須查詢或閱覽上開檔案或資料，必須做文件申請之動作，詳細申請流程我不清楚，但公司所有文件都是依照ISO規定來做文件控管等語（本院卷(四)第164至165頁、卷(七)附件7）；被告林建一於另案刑事案件偵查時陳稱：我一開始在欣寶公司擔任乾製程主任，後來升任為整個製程部之主管。在欣寶公司任職期間，部門員工因業務需要，必須查詢或閱覽新蝕刻技術、自日本MCS公司受讓及技術轉移COF G2技術或know-how（即MCS技轉技術）等相關檔案或資料時，要先填寫紙本之文件申請單，經過申請人所屬部門主管及總經理或副總經理審核簽名後，才能向文件控管中心查詢，我自己要查閱，也是要填寫紙本文件申請單，經由總經理或副總經理審核後放行，欣寶公司是ISO認證公司，所以只要是業務上相關文件，都由文件控管中心控管等語（本院卷(四)第169至170頁、卷(七)附件7）；被告夏志雄於另案刑事案件偵查中陳稱：我在原告入主欣寶公司初期期間，員工因業務需要，必須查詢或閱覽新蝕刻技術相關檔案或資料時，依文件管制辦法，向文管中心提出申請，申請完後經過相關主管單位間簽核後，就可以調閱等語（本院卷(四)第176頁、卷(七)附件7）；被告蔡金保於另案刑事案件調查時陳稱：我在欣寶公司期間，查詢新蝕刻技術或MCS技轉技術相關檔案或資料之流程，須先由申請者填寫資訊系統申請單，由部門主管簽名或蓋章核准後，再經過最高權責主管李宛霞或黃梅雪授權許可，文件管制中心會視申請查閱之內容，列印出來後給李宛霞或黃梅雪覆閱再送交申請者，或是以電子郵件方式傳送至申請者信箱，另公司一

01 般也不允許申請者跨部門查詢相關檔案或資料，這是基於營
02 業秘密防止商業間諜或有心人士竊取公司製程技術機密等語
03 （本院卷(四)第178至179頁、卷(七)附件7），及依被告等人在
04 職時之欣寶公司員工工作規則、獎懲管理辦法（本院卷(三)第
05 161至180頁），亦見欣寶公司明確規範員工不得對外洩漏各
06 單位業務或技術上機密及相關懲戒規定。由上可知，系爭文
07 件A、C如附表一編號1、2技術內容欄所示資訊，原告所承受
08 之欣寶公司於主觀上不僅有當作秘密保護之意，客觀上亦對
09 得接觸資訊之人加以管制，依業務需要分類、分級並授予不
10 同職務等級接觸權限，並訂定相關文件管理辦法，應讓員工
11 能知悉該等資訊屬於公司營業秘密，已使該等資訊以不易被
12 任意接觸之方式予以控管，而能達到保密之目的，應認原告
13 就上開資訊已採取合理保密措施。

14 (4)被告等固辯稱被告李宛霞等人並無與欣寶公司簽署保密契
15 約，欣寶公司全體員工可透過置於設計部內之公用電腦而任
16 意接觸、存取、列印系爭文件；又公司內部人員對於該等技
17 術文件可任意使用USB存取、任意用電子郵件傳送及上傳雲
18 端硬碟等語，並以許勝華、王志宏、伍世宏於另案刑事案件
19 審理時109年8月14日審判筆錄為憑，惟查：

20 ①觀諸證人伍世宏、王志宏、許勝華證述內容（本院卷(二)第64
21 3至653頁、卷(七)附件7），可知證人欣寶公司製程工程師
22 （現為被告易華公司員工）許勝華並無開過設計部之Stella
23 公用電腦，亦無以usb存取過該台電腦(本院卷(二)第645頁)，
24 證人即欣寶公司製程工程師（現為被告易華公司員工）王志
25 宏雖證稱有使用過設計部門放在門口的公用電腦，且有將負
26 責之MCS部分資料從個人Terminal丟到會議室前面電腦，再
27 用USB存取等情（本院卷(二)第648頁、卷(七)附件7），惟此與
28 設計部內之公用電腦是否存有該技術文件而任由員工接觸、
29 取得、列印等情無關，且證人王志宏當時為欣寶公司處理負
30 責MCS部分資料，則其因業務所需而將該資料傳送至公用電
31 腦並使用Stella公用電腦，亦與常情無違；又證人伍世宏雖

01 證稱使用公用電腦開機後不用輸入自己帳號、密碼，當時IP
02 幫我們製作批次檔，只要點下去就可以使用自己部門的檔案
03 等內容，然其亦稱其所謂批次檔是在大辦公室及二樓實驗室的
04 公用電腦，其未使用過設計部的公用電腦，復無法確認批
05 次檔之文件具體內容(本院卷(二)第650至653頁、卷(七)附件
06 7)，則依前述證人證述內容均無從證明設計部內之公用電腦
07 內存有系爭文件A、C，甚而證明當時欣寶公司內部人員得將
08 該等技術文件任意使用USB存取、或用電子郵件傳送及上傳
09 雲端硬碟之事實。

10 ②又證人孫安勇於另案刑事案件審理時證稱：設計部門之公用
11 電腦Stella，是部門主管同意後，才能由與職務相關之同仁
12 使用，當時部門主管是蔡金保，至於蔡金保同意何人使用，
13 我不會知道等語(本院卷(二)第657頁)，是設計部門之公用
14 電腦既須經由部門主管同意後使用，可徵欣寶公司並無任由
15 全體員工透過設計部內之公用電腦接觸、取得、列印其內資
16 料。至被告蔡金保於另案刑事案件審理時雖以證人身份證
17 稱：在欣寶公司設計部之公用電腦，全廠都可以看到系爭文
18 件A的檔案，我把帳號、密碼貼上電腦上面，要使用不需要
19 經過我同意，直接把電腦密碼KEY進去就好了，因為那是我
20 們自己管理的，帳號、密碼是相同的等語(本院卷(五)第312
21 至314頁)，然系爭文件A既為欣寶公司營業秘密，且需視員
22 工職級而有不同存取權限之方式管制，業如前述，被告蔡金
23 保證述之帳號、密碼內容顯非屬欣寶公司開放該資訊存讀取
24 權限之特定員工帳號、密碼，而僅為因業務需求使用開啟公
25 用電腦之帳號、密碼，則被告蔡金保稱該帳號、密碼得以存
26 讀取系爭文件A之相關檔案等情，已難認可採。參以，證人
27 孫安勇前述證詞，可知被告蔡金保為當時設計部部門主管，
28 有管理公用電腦之權限，縱其容任系爭文件A之相關檔案置
29 於設計部公用電腦內，且任由他人讀取該等資訊，實為其管
30 理上疏失，亦不得認欣寶公司有同意全體員工可透過置於設
31 計部內之公用電腦而任意接觸、取得、列印上開技術文件。

01 ③再者，證人孫安勇當時已依任職欣寶公司之總經理即被告李
02 宛霞指示，建構欣寶公司終端機伺服器之資訊系統以保護公
03 司資料，並將除公用電腦外之公司資訊系統設置為不得使用
04 USB存取，復依前述，欣寶公司內部技術文件資料、檔案等
05 亦透過配發員工個人專屬帳號、密碼，按員工職級設定不同
06 存取權限之方式而為控管，並有限制存取資料之相關管理方
07 式，再參酌孫安勇於101年8月6日寄發關於資料夾權限與李
08 宛霞、黃梅雪之電子郵件（本院卷(六)第209至212頁），足見
09 證人孫安勇確依指示將MCS公司相關技轉檔案設置員工觀覽
10 存取之權限，則無論欣寶公司當時是否因經費而未完整執行
11 稽核程序，或建置其他更完整之保密設備或方式，仍不得認
12 其未盡合理保密措施。另欣寶公司是否與被告李宛霞等人簽
13 署保密合約，實非判斷其有無採取合理保密措施之唯一標
14 準，本院綜合審酌前述相關證據，認欣寶公司對於前述技術
15 文件已採取合理保密措施，故被告等此部分所辯，洵非可
16 採。

17 (5)綜上，系爭文件A關於第5頁記載「○○○○○ 000000 ○○○○
18 0○○0000○○○○0○○○○○○○○○○0 000000 ○○○○○」
19 部分及系爭文件C符合營業秘密法第2條所稱「秘密性」、
20 「經濟價值」、「合理保密措施」之要件，自屬營業秘密法
21 所稱之營業秘密。

22 (三)被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄有共同故意侵害原告
23 之營業秘密

24 1.就系爭文件A關於第5頁記載「○○○○○ 000000 ○○○○0○
25 ○0000○○○○0○○○○○○○○○○0 000000 ○○○○○」部分
26 固為原告所有之營業秘密，惟系爭文件A之技術內容與系爭
27 專利辛請求項1、6部分非實質相同而不具實質貢獻，均業如
28 前述，自無侵害原告營業秘密或專利申請權之情事。是以下
29 就系爭文件C部分，即應論述被告等有無侵害原告營業秘密
30 之情事；而系爭文件E、F、G部分，既不具秘密性，自非屬

原告所有之營業秘密，則僅論述是否有侵害原告專利申請權之情事，先予敘明。

2.系爭文件C部分

(1)查系爭文件C原為欣寶公司向MCS公司所購置，且置於欣寶公司所管制之專用資料夾內，嗣由原告合併欣寶公司而取得其相關權利，業如前述，而被告黃梅雪於被告易華公司辦公室遭查扣之硬碟中儲存有系爭文件C，為被告等所不爭執（本院卷(二)第220頁、秘保卷第661至662頁），並有法務部調查局南部地區機動工作站110年5月20日調南機防字第000000000000號函影本暨所附數位證物鑑識匯出檔光碟、匯出資料截圖在卷可查（本院卷(二)第235至239頁、卷末證物袋），可徵被告黃梅雪於被告易華公司辦公室遭查扣之硬碟中存有檔案名稱「NewEtching-G2 Photo Mask翻譯」，確為重製欣寶公司系爭文件C而來。至被告等雖辯稱被告黃梅雪未曾開啟過扣案隨身硬碟內之系爭文件C，自與系爭專利壬之申請無關等語（秘保卷第661頁），並提出系爭文件C鑑識時間光碟資訊、鑑定證人黃逸華於另案刑事案件之證述內容（本院卷(六)第173至175頁、第493頁），然觀諸鑑定證人黃逸華所為證述內容，係經被告等擷取片段而提出，且核其所為係對訴外人楊孝武之扣案物內檔案鑑識結果之證述，而非針對被告黃梅雪前開扣案之隨身硬碟（本院卷(六)第175頁），則該證詞是否得證明被告黃梅雪未曾開啟過扣案隨身硬碟內之系爭文件C，已屬有疑。縱認被告黃梅雪確未開啟過上開扣案隨身硬碟，然實無法排除被告黃梅雪尚有重製其他備份資料，或變更系爭文件C檔案名稱等情之可能，是被告等上開所辯自非可採。

(2)系爭文件C當時存放於欣寶公司電腦伺服器之「5-3-設計技術Gr（CAD設計相關）-保哥」檔案資料夾，被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保均有對該資料之存取權限，此有還原磁帶及檢視存取權限過程之公證書暨所附附圖167、174、181內容在卷可參（本院卷(五)第23至26頁、第199頁、第206頁、第213

頁)；而被告李宛霞、黃梅雪原於欣寶公司任職時分別擔任總經理、副總經理，依其等當時業務範圍均已知悉系爭文件C之技術內容，被告等亦不否認被告李宛霞、黃梅雪於欣寶公司時具存取系爭文件C之權限(秘保卷第633頁)；又被告蔡金保、夏志雄則於另案刑事案件偵查中分別陳稱：「我在欣寶公司期間，因為只負責圖面的設計和審核，製程的機台和配方我都沒有經手，所以我不會申請查詢新蝕刻技術相關檔案或資料，至於查詢流程是必須先經過公司的文件管制中心審核後，經製程主管林建一或夏志雄核准，再經最高權責主管可能是總經理或副總同意後，文管承辦人會把相關調閱資料傳送給申請者並在文件上簽章，申請者才能查詢或閱覽相關檔案或資料。又MCS技轉技術相關檔案或資料，查詢申請流程如同前所述。」(本院卷(四)第178頁)、「我在原告入主欣寶公司初期期間，員工因業務需要，必須查詢或閱覽新蝕刻技術相關檔案或資料時，依文件管制辦法，向文管中心提出申請，申請完後經過相關主管單位間簽核後，就可以調閱」(本院卷(四)第176頁)等語，綜上可證被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄均有查閱系爭文件C之權限。再參酌被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄於任職欣寶公司時，均為至日本接受MCS公司相關技術轉移受訓之員工，業如前述，益徵其等自得接觸系爭文件C，且應知悉系爭文件C為欣寶公司之營業秘密。另被告李宛霞、黃梅雪於103年7月1日受聘於被告易華公司擔任被告易華公司之總經理、副總經理，並負責與原公司相同之職務內容(本院卷(一)第479至480頁)，其等為該領域之專業人士，且為被告蔡金保、夏志雄之上級主管，應認被告蔡金保、夏志雄以系爭專利王為發明人為申請專利時，其等即應知悉系爭專利王請求項2、4、6、9之技術內容，與欣寶公司原所有系爭文件C如附表一編號2所示之技術內容，屬於實質相同之創作，是被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄均知悉申請系爭專利王之行為，將造成原告就系爭文件C如附表一編號2所示之技術內容

遭公開而喪失秘密性，仍為系爭專利壬之申請及相關批核，顯屬有故意，均為原告受有損害之共同原因，自應成立共同侵權行為。至被告等雖辯稱被告李宛霞、黃梅雪未參與系爭專利壬之申請等語(秘保卷第655頁)，然申請專利需花費相當之金額，且專利權取得後日後之維護、管理亦需要一定之人力與費用，依被告蔡金保等人於易華公司之職務，實難認其等得以獨自決定是否申請該等專利，又被告李宛霞、黃梅雪既為被告蔡金保等人之上級主管，且擔任公司總經理、副總經理等級之管理階層，當無可能對於公司申請專利毫不知情，並全權授權被告蔡金保等人處理，是被告等上開所辯，即非有據。

- (3)至被告黃嘉能部分，原告雖稱被告黃嘉能為被告易華公司之董事長，於105年8月25日檢調搜索扣押後，即知悉被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄所持有之COF技術涉及原告之營業秘密，仍同意並授權以被告易華公司名義將原告所有營業秘密之技術內容用於申請並取得系爭專利，自為共同侵權行為等語，而被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄固因違反營業秘密法案件而於105年間經檢調搜索扣押而開始偵查，惟該違反營業秘密法案件迄至108年間始經檢察官提起公訴，此觀另案刑事案件案號為108年智訴字第2號即明(本院卷(一)第22頁)，基於偵查不公開原則，被告黃嘉能是否得於105年8月25日檢調搜索扣押或偵查過程中時，即確實知悉其他被告擅自重製原告之營業秘密為何，甚或得以確認該等營業秘密之技術內容與系爭專利壬請求項2、4、6、9有實質相同之處，實非無疑。又系爭專利壬係於另案刑事案件起訴前之107年9月19日即向智慧局申請專利，且僅上開請求項與系爭文件C如附表一編號2所示之技術內容有實質相同之處，其餘部分請求項均係透過被告易華公司自身技術或公開資訊所為申請，則被告黃嘉能主觀上認為被告易華公司得以申請系爭專利壬，亦難認與常情相違。此外，原告並未舉證證明被告黃嘉能明確知悉被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄

01 侵害其上述營業秘密之事實，更未能舉證被告黃嘉能有何知
02 悉或因重大過失而不知上開文件為營業秘密法第10條第1項
03 第1款規定之營業秘密，而取得、使用或洩漏該營業秘密
04 （即營業秘密法第10條第1項第2款構成要件）之事實，自無
05 從認定其有故意或過失侵害原告營業秘密之情事。是以，原
06 告主張被告黃嘉能應與被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志
07 雄連帶負損害賠償責任，應屬無據。

08 (4)末按法人對於其董事或其他有代表權之人，因執行職務所加
09 於他人之損害，應與行為人連帶負損害賠償責任，民法第28
10 條定有明文。所謂執行職務，凡在外觀上足認為機關之職務
11 行為，及在社會觀念上，與職務行為有適當牽連關係之行為
12 者，均屬之。故利用職務上之機會及與執行職務之時間或處
13 所有密切關係之行為，其在客觀上足認為與執行職務有關，
14 而不法侵害他人之權利者，即令係為自己利益所為之違法行
15 為，亦應包括在內（最高法院107年度台上字第33號判決可
16 參）。查被告李宛霞為被告易華公司之總經理，係執行並負
17 責易華公司之實際營運，為該公司內部最高階之專業經理
18 人，對外應屬該公司有代表權之人。被告李宛霞就以被告易
19 華公司名義申請取得如系爭專利壬，核屬其本於總經理身分
20 之執行職務所為，該行為既侵害原告所有系爭文件C如附表
21 一編號2所示之技術內容，則被告易華公司自應負民法第28
22 條之法人侵權責任。是以，原告主張被告易華公司應依民法
23 第28條規定，就被告李宛霞前述應賠償金額與其負連帶賠償
24 責任，當屬有據。至原告主張被告易華公司應依民法第28條
25 規定與被告黃嘉能、黃梅雪連帶負擔損害賠償；及被告易華
26 公司應依公司法第23條第2項規定與被告黃嘉能、李宛霞、
27 黃梅雪連帶負擔損害賠償部分，因其未能舉證證明被告黃嘉
28 能有何不法侵害原告權利之行為，亦未說明被告黃梅雪何以
29 符合公司董事或其他有代表權之人等事實或提出相關證據；
30 又原告係認本件共同侵權行為人為系爭專利壬所列名之發明
31 人與被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪，則被告易華公司既非本

件共同侵權行為者，被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪並無從依
公司法第23條第2項規定與被告易華公司連帶，與該條之構
成要件實有不合，故原告此部分主張，均非可採。

(5)綜上，原告所有系爭文件C如附表一編號2所示之技術內容為
其營業秘密，被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄未經原
告同意或授權，即將原告前開營業秘密以申請系爭專利壬之
方式公開於眾，自屬侵害原告就系爭文件C如附表一編號2所
示技術內容之營業秘密。

3.系爭文件E、F、G部分

(1)按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；專利申請權
人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型
創作人、設計人或其受讓人或繼承人；受雇人於職務上所完
成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人
，雇用人應支付適當之報酬，但契約另有約定者，從其約
定，專利法第5條、第7條第1項分別定有明文。準此，在僱
傭關係中所為職務上之發明、新型，其發明專利、新型專利
之專利申請權，除契約另有約定外，原則上為發明人、新型
創作人之雇用人所有之權利；倘非雇用人或自該雇用人受讓
權利之人，自無從取得發明專利、新型專利之專利申請權。

(2)經上開所述之比對分析，系爭文件E之技術內容對系爭專利
庚請求項1、2、11及系爭文件F之技術內容對系爭專利癸請
求項1、8、系爭專利癸-1請求項1，以及系爭文件G之技術內
容對系爭專利丑請求項1為實質相同而具實質貢獻，且系爭
文件E為CAM作業指導參考表、系爭文件F、G為產品之設計規
範書，就如附表一所示之技術內容原屬欣寶公司員工於任職
期間職務上所完成之發明、創作，其專利申請權及專利權自
均歸屬於欣寶公司所有，嗣因原告與欣寶公司合併，合併後
原告為存續公司，欣寶公司為消滅公司，欣寶公司全部資產
及權利、義務均由原告概括承受。又被告蔡金保、林建一、
夏志雄原均任職於欣寶公司，而系爭專利庚之創作人被告蔡
金保、林建一分屬設計工程部、製程工程部（本院卷(五)第10

至11頁)對於存放於【CAD設計部(專用)】資料夾之系爭文件E均有存取權限，有公證書在卷可參(本院卷(五)第27至31頁、第227至281頁)，應得知悉並接觸系爭文件E所示之技術內容；另被告黃梅雪則對於系爭文件F、G有存取權限，並於離職時將該等文件重製於硬碟中攜出，亦有公證書、法務部調查局南部地區機動工作站110年5月20日調南機防字第0000000000號函影本暨所附數位證物鑑識匯出檔光碟、匯出資料截圖附卷可佐(本院卷(二)第235至239頁、卷末證物袋光碟、卷(五)第26至27頁、第214至226頁)，以系爭文件F、G所示之技術內容分別與系爭專利癸請求項1、8、系爭專利癸-1請求項1及系爭專利丑請求項1為實質相同之近似程度，堪認被告蔡金保、林建一、夏志雄應有透過被告黃梅雪而間接接觸系爭文件F、G之可能。因此，系爭專利庚請求項1、2、11及系爭專利癸請求項1、8、系爭專利癸-1請求項1，以及系爭專利丑請求項1之發明、新型構思既係分別衍生自系爭文件E、F、G，依專利法第7條第1項規定，此部分專利申請權自屬於原告所有。

(3)原告為系爭專利庚、癸、癸-1、丑之專利申請權人之一，原告亦已請求確認為共同申請權人而為如訴之聲明第一項所示，即已得回復原告損害發生前之原狀，自無再另請求損害賠償之理，是原告另請求被告等就侵害專利申請權部分，應負損害賠償責任，自屬無據，應予駁回。

五、綜上所述，系爭文件E之技術內容對系爭專利庚請求項1、2、11及系爭文件C之技術內容對系爭專利壬請求項2、4、6、9及系爭文件F之技術內容對系爭專利癸請求項1、8、系爭專利癸-1請求項1，以及系爭文件G之技術內容對系爭專利丑請求項1均為實質相同而具實質貢獻；另系爭文件C如附表一編號2所示之技術內容為原告所有之營業秘密。被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄所為申請系爭專利壬共同侵害原告就系爭文件C如附表一編號2技術內容所示之營業秘密，自應連帶負損害賠償責任，而被告易華公司因其有代表權之

人即被告李宛霞執行職務加損害於他人，亦應與被告李宛霞連帶負損害賠償責任。至此部分損害賠償之數額，需進一步審理，並以上開判斷為前提，爰先為中間判決如主文所示。

中 華 民 國 112 年 12 月 12 日

智慧財產第四庭

法 官 林怡伸

以上正本係照原本作成。

不得獨立提起上訴。

中 華 民 國 112 年 12 月 20 日

書記官 鄭楚君

附表一：

編號	原告技術文件	技術內容	卷證出處
1	技術文件A SIMPAL-AW11-Ne wetching(ET3) -8-Low pressur e-DEV-1-MEC-TS T.xls	文件右上角記載「程式版本2011/11/30-A」，可知文件完成日期為西元2011年11月30日。 ○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○000000○○○○0○○0000○ ○○0○○○○○○000000000000○○○○○○○○ ○○○○○○00○○000○○00○○000○○○○ ○○○○0000000○○○○○○○○○○○○○○○○ 0○○○○○○○○0○○○○○○00○○00○○0 ○○○○○○○○0○○○○○○00○○0 ○ ○○○○○○○○0○○○○○○00○○0 ○	原證13 秘保卷第9 至14頁
2	技術文件C NewEtching-G2 Photo Mask 翻 譯.xls	文件電子檔之資訊頁面(原證25)顯示此文件作成日期為西元2012年4月13日(本院卷(二)第39頁)。 ○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○00000○○○○○○00000○○0○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○0○○0○○○○000000○○000○○○○○	原證15 秘保卷第1 5至31頁

1	中華民國第M586032號「軟性電路板」新型專利（系爭專利庚）	108年7月12日	108年1月1日	蔡金保、林建一、黃信揚	被告易華公司
2	中華民國第M587421號「印刷電路板之對位圖案系統」新型專利（系爭專利辛）	108年8月15日	108年1月1日	蔡金保、黃信揚、夏志雄、林建一	
3	中華民國第I682480號「印刷電路板佈線系統」發明專利（系爭專利壬）	107年9月19日	109年1月11日	蔡金保、夏志雄、黃信揚、蘇盈君	
4	中華民國第I687137號「具減少彎折反彈力之軟性電路板」發明專利（系爭專利癸）	107年1月5日	109年3月1日	蔡金保、林建一、夏志雄、楊孝武	
5	中國大陸第110012587號「具有減少彎折反彈力的軟性電路板」發明專利（系爭專利癸-1）	107年3月27日	109年8月11日	蔡金保、林建一、夏志雄、楊孝武	
6	中華民國第M586029號「具有線路對位記號之軟性電路板」新型專利（系爭專利子）	108年7月12日	108年1月1日	蔡金保、黃信揚、鄭佩芬	
7	中華民國第M586506號「印刷電路板之補強塊」新型專利（系爭專利丑）	108年8月15日	108年1月11日	蔡金保、鄭佩芬、夏志雄、林建一	
8	中華民國第M586030號「具有孔位檢查記號之軟性電路板」新	108年7月12日	108年1月1日	蔡金保、鄭佩芬、楊孝武	

01	型專利（系爭專利 寅）				
----	----------------	--	--	--	--

02 附表三：

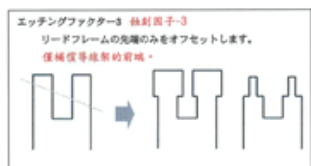
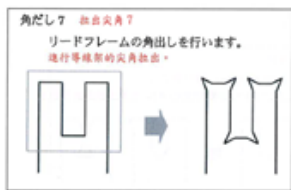
03	編號	技術文件	原告主張實質相同 所對應之專利請求 項	系爭專利登記發明 人或創作人
	1	E 原證11	系爭專利庚請求項 1、2、11	蔡金保、林建一、 黃信揚
	2	A 原證13	系爭專利辛請求項 1、6	蔡金保、黃信揚、 夏志雄、林建一
	3	C 原證15	系爭專利壬請求項 2、4、6、9	蔡金保、夏志雄、 黃信揚、蘇盈君
	4	F 原證17	系爭專利癸請求項 1、8 系爭專利癸-1請求 項1	蔡金保、林建一、 夏志雄、楊孝武
	5	G 原證19	系爭專利子請求項 1、4、9 系爭專利丑請求項1 系爭專利寅請求項7	蔡金保、黃信揚、 鄭佩芬 蔡金保、鄭佩芬、 夏志雄、林建一 蔡金保、鄭佩芬、 楊孝武

04 附表四：

05	編號	被告提出 系爭文件 不具秘密 性之證據	公開日期 技術內容	卷頁

1	被證10	西元2016年12月20日	本院卷(二) 第323至325頁
		為Stella公司網站對Stella Vision for JAVA系列軟體之簡介，由被證27之公證書附件5至8(本院卷(三)第537至547頁)，於網站時光回溯器，得知被證10之網頁自西元2016年12月20日起，即已存在於網路上，被證10之公開日期為西元2016年12月20日，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，但晚於系爭文件A、C之日期。 被證10頁面標題為什麼是「Stella Vision for JAVA CAD/CAM」系統？第1頁標題下方第1至7行Stella Vision for JAVA是下述三款軟體的通稱。Fine Vision for JAVA其係專門用於編輯精細圖樣，並提供多種濕式蝕刻之功能。其可以用於處理優異的輪廓提取處理，處理涉及補償處理之內外部自動判斷，以數個圖像選擇指令處理辨識選擇特定資料。另外，其可以透過將圖案相連的邏輯運算處理來處理熟練的製程編輯處理，透過輸入冪參數來共同處理精細的濕式蝕刻製程。此外，其可以進行濕式蝕刻製程的修正，該修正係對應於維持最小間距的形態進行線性補償(本院卷(三)第491頁)。	
2	被證11	西元2016年12月20日	本院卷(二) 第327至334頁
		為Stella公司網站之Fine Vision版軟體功能說明，該網頁第1列顯示Stella vision至Video movie等按鈕與被證10	

		等按鈕得互相勾稽被證11之公開日期同被證10之公開日期為西元2016年12月20日，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，但晚於系爭文件A、C之日期。 被證11第1頁Fine Vision欄第1至4行記載Fine Vision提供你非常有效、強力但便利的功能，例如獨特的輪廓修邊、辨識物件內側及外側的補償指令。其配備了數個選擇功能，因此你可以使用多樣且喜好的方式，以最有效率的方法選擇特定資料。透過邏輯運算及計算重疊物件的技術性編輯。透過簡單的參數輸入，自動的精細設計及極細蝕刻資料，保持最小間距且根據資料形狀的蝕刻資料線性補償修正。第4頁Etching Factor（蝕刻因子）欄第1行記載在改變及補償導線架之形態中，亦可以僅針對尖端部分的形態進行改變。第5頁Put Horn（拉出尖角）欄第1行記載此功能改變導線架之轉角處的形態，如下所示地在其圖案中拉出尖角。（本院卷(三)第493頁）	
3	被證12	西元2003年4月1日 為Stella Fine Vision for JAVA產品說明書，以刊載「2003.4.1」字樣，該第3方公司所下載之產品說明書，並且原、被告均使用該第3方公司之軟體，據此可知，依一般經驗法則，認定被證12於西元2003年4月1日已公開之事實，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期。	本院卷(二)第335至341頁

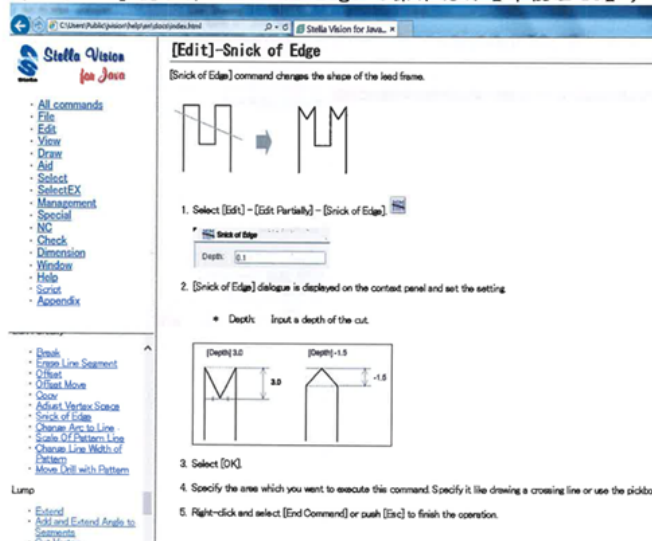
		被證12第3頁Special右上方第1至5行記載Stella Vision for JAVA具有特殊資料整形操作功能。藉由這些功能，其可以立即且精準地對複雜的資料執行整形操作。第3頁Special右下方欄第1及7行記載Function of plastic operation 整形操作功能。Etching Factor，Put Horn：蝕刻因子、拉出尖角。(本院卷(三)第495頁)	
4	被證13	西元2007年5月25日 為西元2007年5月25日版Stella Vision for JAVA概要說明書，封底以刊載「2007/05/25」字樣，並且原、被告均使用該第3方公司之軟體，據此可知，依一般經驗法則，認定被證13於西元2003年4月1日已公開之事實，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期。 被證13之Stella Vision for JAVA 概要說明書第47頁之變更導線架的形狀、第48頁之僅補償導線架的前端、第51頁之蝕刻項目中載有拉出尖角7 (Put Horn)。 圖式：(本院卷(三)第497至498頁) 〔第47頁〕：  〔第48頁〕：  〔第51頁〕： 	本院卷(二)第343至424頁

5	被證14	西元2007年7月16日	本院卷(二) 第425頁
		為Stella軟體內建之關於[Special]-Etching Factor 3 功能之操作說明，被證28(本院卷(三)第715頁)為西元2007年7月16日取得Stella公司授權之電郵，被證29(本院卷(三)第719至728頁)為Stella Corporation 公司製之CAD系統維護契約書，本契約期間西元2008年(平成20)2月1日至2008年(平成20)9月30日，第8頁附屬書維護對象機器一覽表為設備名稱Fine Vision for JAVA系統蝕刻選項，由上述內容可知，被證14為Stella軟體內建之關於[Special]-Etching Factor 3功能之操作說明(本院卷(三)第499頁)於西元2007年7月16日公開使用，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期。 被證14揭露線路前端形狀調整為具有弧角之導圓角(本院卷(三)第732頁)。 { 點擊 Help 後取得 Etching Factor 3 之操作說明【即被證14】 }： 	
6	被證15	西元2007年7月16日	本院卷(二) 第427頁
		為Stella軟體內建之關於[Edit]-Snick of Edge功能之操作說明於西元2007年7月16日公開使用已如前述，其公開日期	

早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期。

被證15揭示頁面標題：編輯-邊緣切口，標題下方第1行揭示邊緣切口指令改變導線架的形狀，步驟2:邊緣切口對話框被顯示於上下文功能表(context panel)並配置設定。(參本院卷(三)第501頁)，如下所示在其圖案中邊緣切口拉出尖角或內凹尖角，對話框被顯示並設定前述尖角之深度參數(Depth)，並且以數值-1.5表示拉出尖角，以數值3.0表示內凹尖角(本院卷(三)第734頁)。

{ 點擊 Help 後取得 Snick of Edge 之操作說明【即被證 15】 } :



7

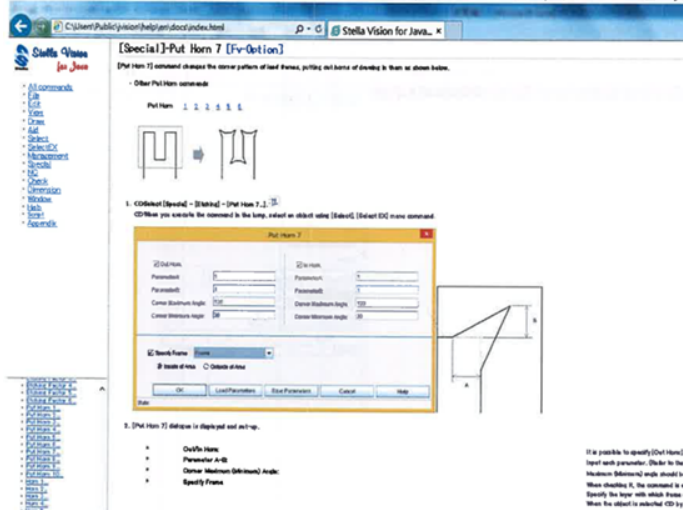
被證16

西元2007年7月16日

為Stella軟體內建之關於[Special]-Put Horn 7功能之操作說明於西元2007年7月16日公開使用已如前述，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期。

被證16之頁面標題：特殊-拉出尖角7，拉出尖角7指令改變導線架之轉角處的形態，如下所示地在其圖案中拉出尖角

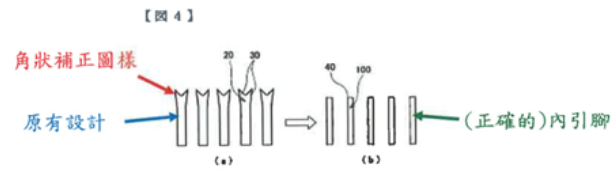
本院卷(二)
第429頁

		(參本院卷(三)第503頁)，對話框被顯示並設定Out horn及In horn，參數A及B，參數A及B以右上直角為基準點計算長度(本院卷(三)第736頁)。 { 點擊 Help 後取得 Put Horn 7 之操作說明【即被證 16】 } 	
8	被證39	西元2006年7月 為台灣電路板協會於西元2006年7月再版「高密度印刷電路板技術」書籍，該書第165頁記載「CAM則會針對製作程序中所可能產生的產品尺寸變化量進行補償」(本院卷(五)第377頁)，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、C之日期	本院卷(五)第375至380頁
9	被證40	西元2006年9月 為台灣電路板協會於西元2006年9月再版「電路板影像轉移技術」書籍，該書第109頁記載「工作底片……可以利用電腦進行尺寸補償」(本院卷(五)第383頁)及第116頁記載「底片上線路的寬度必需要作適度調整……可以用電腦輔助製造系統進行繪製修改之後出圖」(本院卷(五)第385頁)，第131頁記載「……」	本院卷(五)第381至389頁

		兩個對位靶的對位系統……」(本院卷(五)第387頁)，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A、E之日期。	
10	被證41	91年11月29日 為第十九屆機械工程研討會於91年11月29、30日發表「高深寬比化學濕蝕刻凸形角落補償尺寸之探討」論文，該文第3頁第3.1節及圖9記載「最快蝕刻面發展出三角形補償方式」(本院卷(五)第393頁)，其公開日期早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件A之日期。	本院卷(五)第391至398頁
11	被證42	西元2008年4月17日 被證42為西元2008年4月17日公開之日本特開第2008-91706號「TAB帶體的製造方法」專利案，其公開日早於所有系爭專利之申請日或優先權日，為所有系爭專利之先前技術，亦早於系爭文件C之日期。 被證42說明書第【0005】段記載第4圖(a)之一例示中，在用於形成內引腳100之光阻圖案20的前端部，增加角狀的修正圖案30。根據此提案，藉由增加修正圖案30，以濕式蝕刻製程經圖案加工之銅箔這樣的導體箔所形成的內引腳100，係可抑制其前端部萎縮等形狀不良或尺寸不良，可期待形成為如第4圖(b)所示的幾乎正確且細長之矩形圖案。(參本院卷(五)第411頁)	本院卷(五)第399至409頁

01

被證42圖4：(秘保卷第349頁)



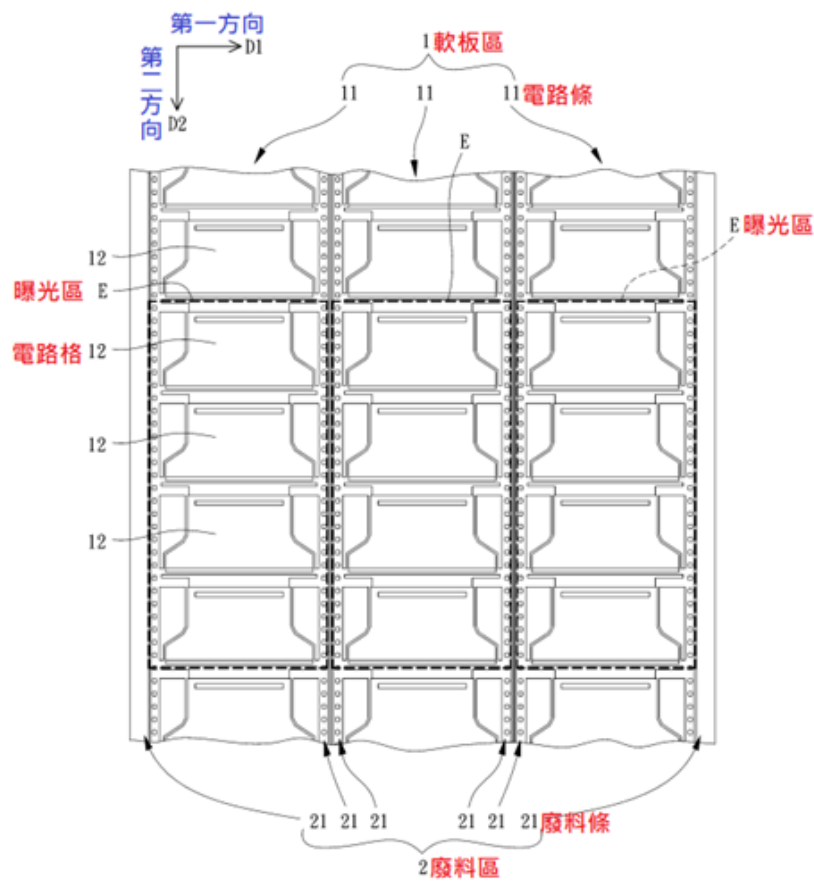
02

附圖：

03

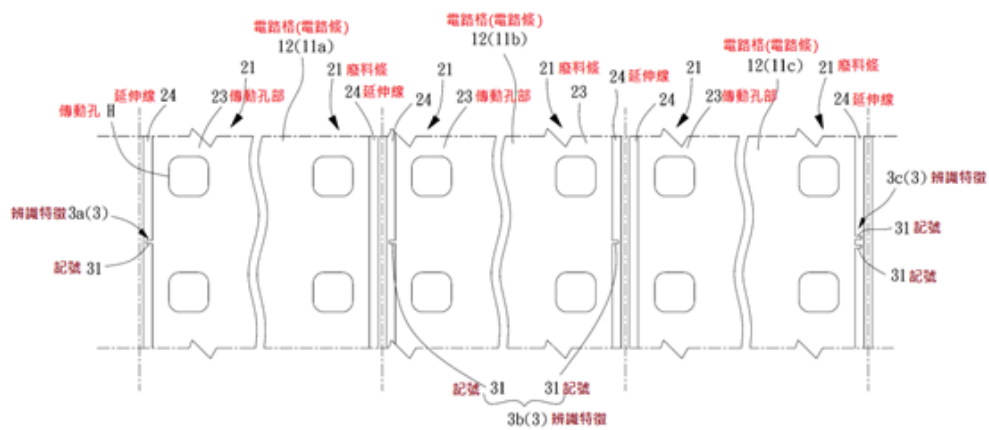
附圖一：系爭專利庚主要圖式(本院卷(一)第62、64、66、68頁)

系爭專利庚第1圖：



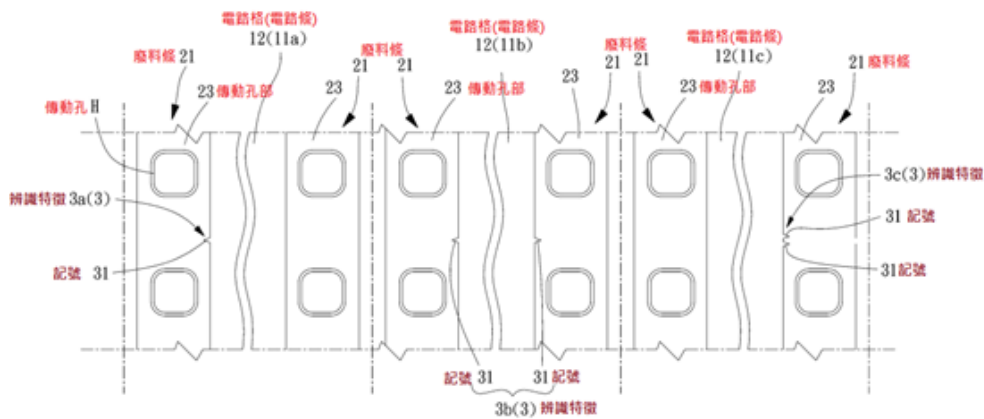
【第 1 圖】

系爭專利庚第3圖：



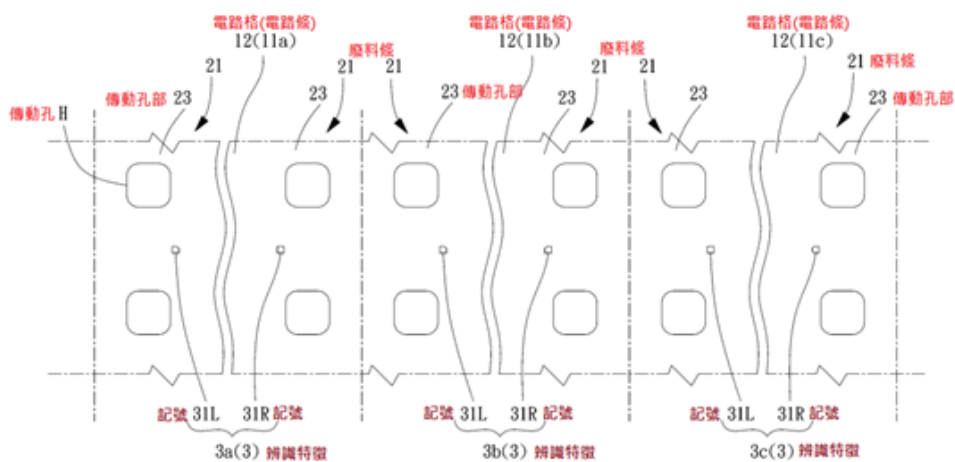
【第 3 圖】

系爭專利庚第5圖：



【第 5 圖】

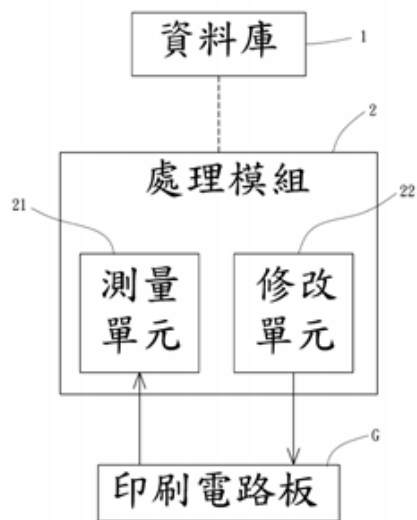
系爭專利庚第7圖：



【第 7 圖】

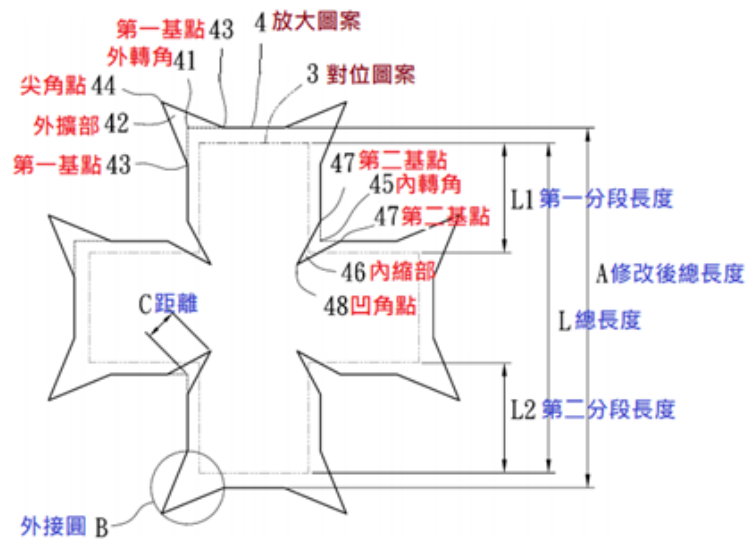
附圖二：系爭專利辛主要圖式(本院卷(一)第87至88頁)

系爭專利辛第3圖：



【第 3 圖】

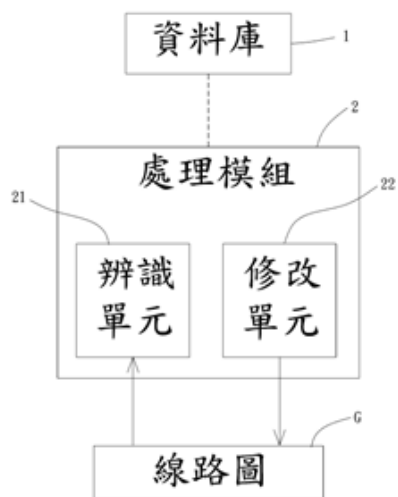
系爭專利辛第4圖：



【第 4 圖】

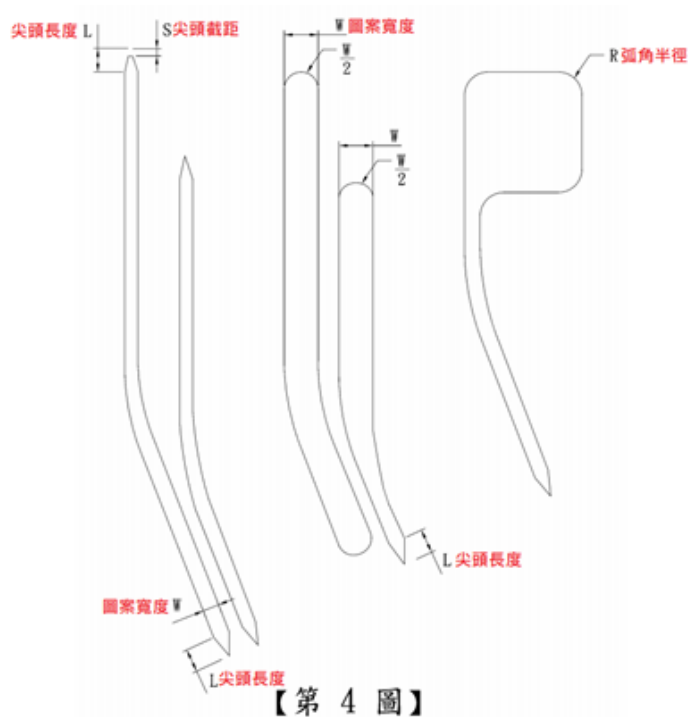
附圖三：系爭專利壬主要圖式(本院卷(一)第107至108頁)

系爭專利壬第3圖：



【第 3 圖】

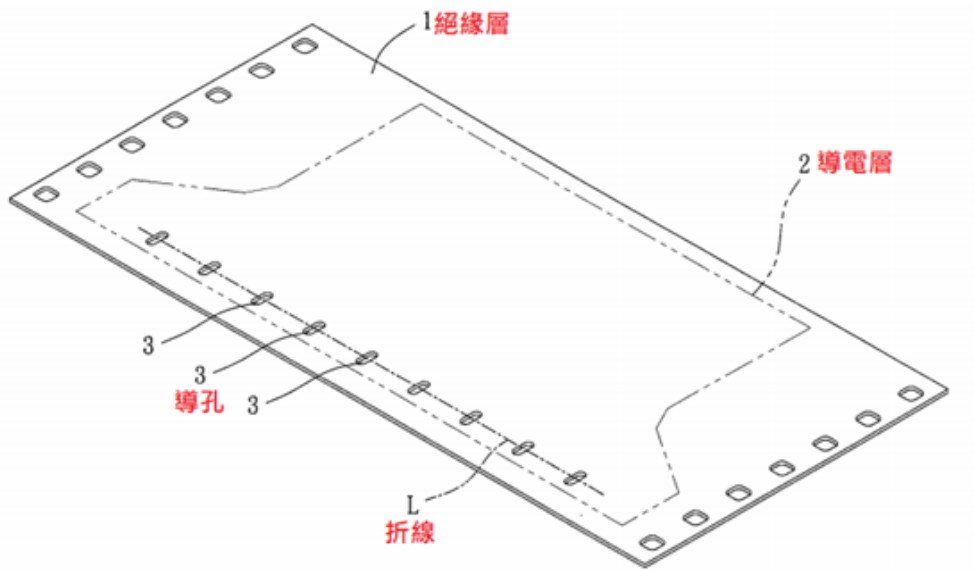
系爭專利王第4圖：



【第 4 圖】

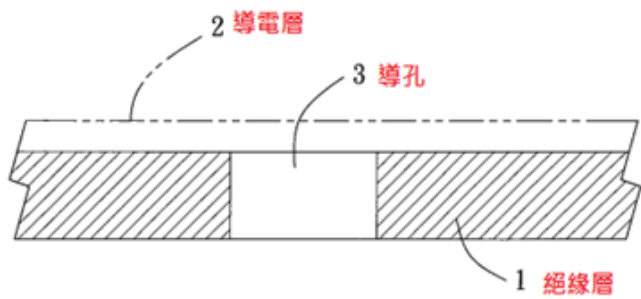
附圖四：系爭專利癸、癸-1主要圖式(本院卷(一)第127、129、131、143、145、147頁)

系爭專利癸、癸-1第1圖：



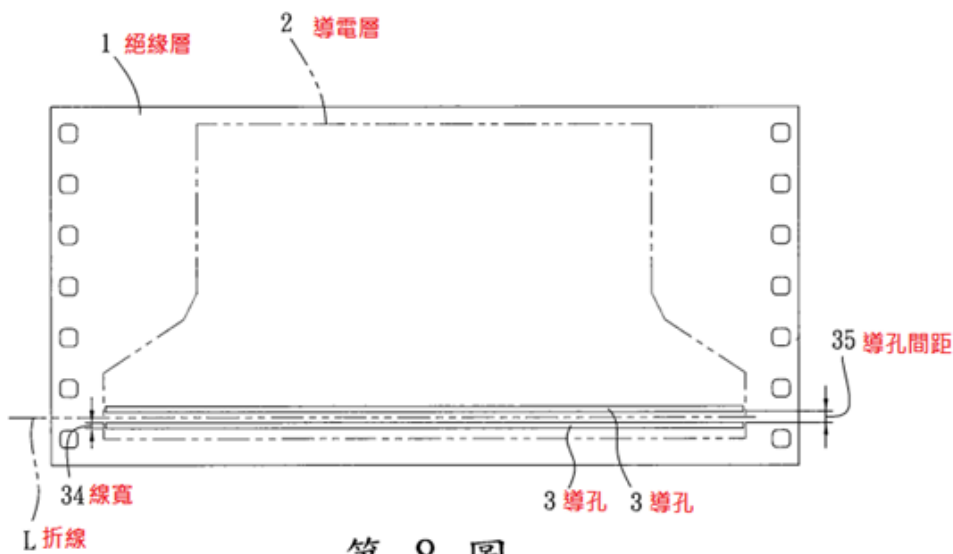
第 1 圖

系爭專利癸、癸-1第3圖：



第 3 圖

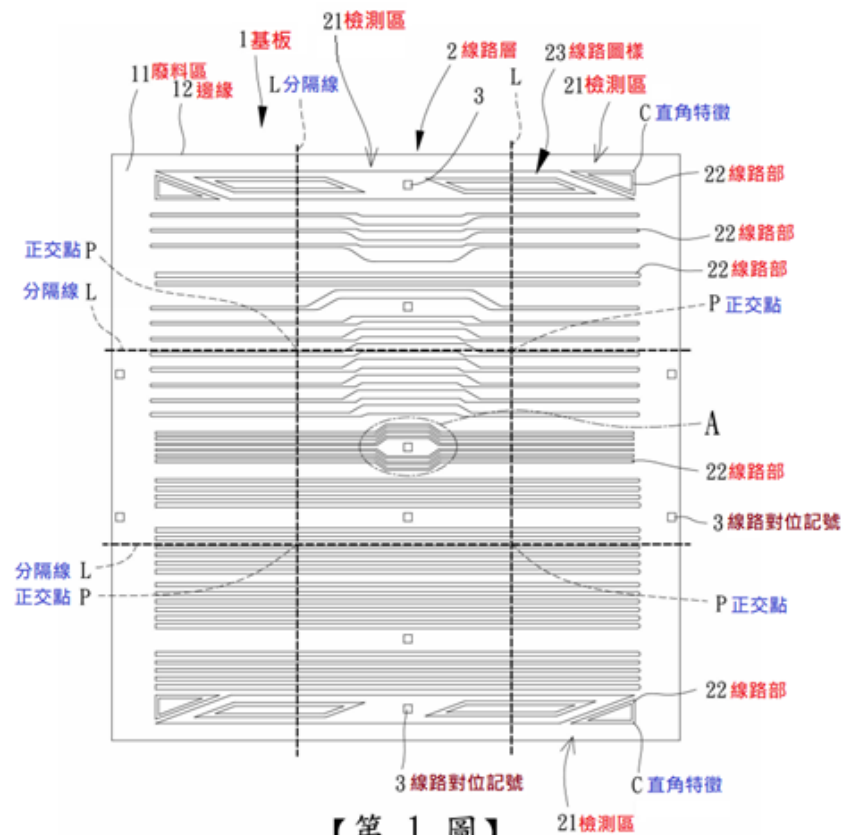
系爭專利癸、癸-1第8圖：



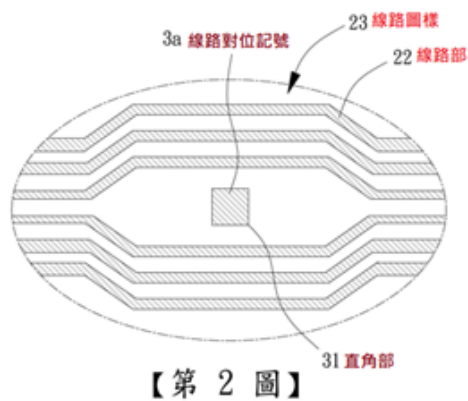
第 8 圖

附圖五：系爭專利子主要圖式(本院卷(一)第153、259頁)

系爭專利子第1圖：

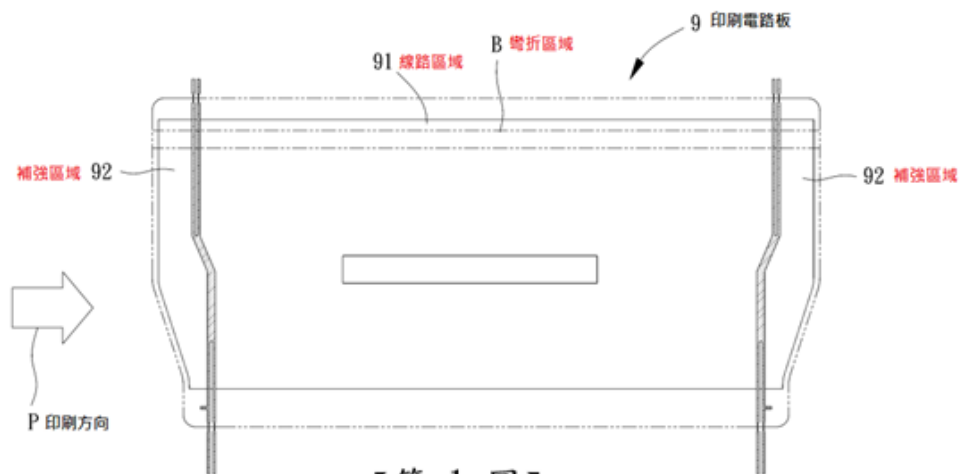


系爭專利子第2圖：



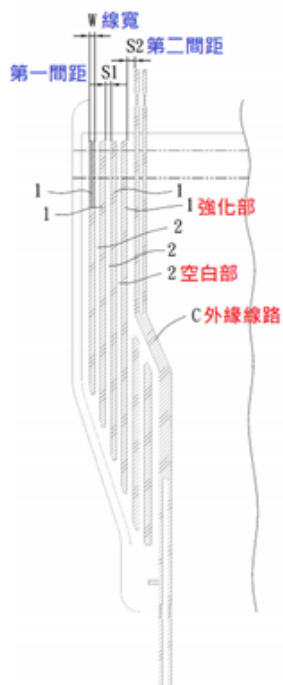
附圖六：系爭專利丑主要圖式(本院卷(一)第178至179頁)

系爭專利丑第1圖(習知技術)：



【第 1 圖】

系爭專利丑第2圖：



【第 2 圖】

附圖七：系爭專利寅主要圖式(本院卷(一)第182頁)

系爭專利寅第1圖：

